



Brüssel, den 25. November 2022
(OR. en)

14668/22

**Interinstitutionelles Dossier:
2022/0032(COD)**

**COMPET 885
IND 466
RC 57
RECH 595
TELECOM 454
FIN 1212
CADREFIN 197
CODEC 1730**

VERMERK

Absender:	Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)
Empfänger:	Rat
Nr. Vordok.:	14454/22
Nr. Komm.dok.:	6170/22 + ADD 1
Betr.:	Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz) – <i>Allgemeine Ausrichtung</i>

I. EINLEITUNG

1. Am 8. Februar 2022 hat die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz)¹ vorgelegt. Eine förmliche Folgenabschätzung liegt nicht bei.

¹ Dok. 6170/22 + ADD 1.

2. Ziel der vorgeschlagenen Verordnung ist es, das europäische Halbleiter-Ökosystem zu stärken, die Sicherheit der Versorgung der EU mit Halbleitern zu erhöhen und neue Märkte für hochmoderne europäische Technologien zu erschließen. Die Initiative soll die gesamte Wertschöpfungskette vom Entwurf bis zu den Fertigungskapazitäten abdecken. Sie zielt insbesondere darauf ab, die Risiken künftiger Engpässe oder Spannungen bei der Halbleiterversorgung in Europa zu begrenzen und erforderlichenfalls die Folgen einzudämmen und so zur industriellen Widerstandsfähigkeit Europas beizutragen. Außerdem soll so ein europäischer Ansatz für diese Frage erarbeitet werden, der zur Stärkung des Binnenmarkts beitragen sollte.
3. Um diese Ziele zu erreichen, stützt sich der Vorschlag auf drei Säulen:
 - Säule 1: Lancierung der Initiative „Chips für Europa“ zur Unterstützung des Aufbaus technologischer Kapazitäten und großmaßstäblicher Innovationen in der gesamten EU, um die Entwicklung und den Einsatz hochmoderner Halbleiter- und Quantentechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen, mit denen die Fähigkeiten und Kompetenzen der EU in den Bereichen fortschrittlicher Entwurf, Systemintegration und Komponentenproduktion gestärkt werden; im Einzelnen umfasst die Initiative „Chips für Europa“ fünf operative Ziele: die Entwicklung von Pilotanlagen zur Erprobung innovativer Verfahrenstechnologien und Entwurfskonzepte, die Entwicklung einer Entwurfsplattform zur Erleichterung des Zugangs zu Entwurfsressourcen, die Unterstützung von Quantenchips, die Einrichtung von Kompetenzzentren und die Stärkung von Fertigkeiten zur Verbesserung des Zugangs und des Talents in der gesamten Union sowie einen Chip-Fonds zur Unterstützung von Start-ups und der Expansion von KMU;
 - Säule 2: Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch Anreize für mehr Investitionen und Produktionskapazitäten in der Halbleiterfertigung sowie im Packaging und in der fortschrittlichen Erprobung und Montage mittels neuartiger integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe;

- Säule 3: Einrichtung eines Mechanismus zur Koordinierung der Überwachung und Krisenreaktion zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, um die Zusammenarbeit mit und zwischen Mitgliedstaaten zu verstärken, das Angebot an Halbleitern zu beobachten, die Nachfrage zu schätzen, Engpässe zu antizipieren, die Aktivierung der Krisenstufe auszulösen und ein spezielles Instrumentarium einzusetzen.
4. Die Kommission schlug vor, die Verordnung auf Artikel 114, Artikel 173 Absatz 3, Artikel 182 Absatz 1 und Artikel 183 AEUV zu stützen, die sich auf die Angleichung der Rechtsvorschriften, die Industrie sowie Forschung und technologische Entwicklung beziehen. Bei der Prüfung des Kommissionsvorschlags in den Vorbereitungsgremien des Rates wurde jedoch festgestellt, dass Artikel 182 Absatz 1 und Artikel 183 AEUV als Rechtsgrundlage nicht geeignet sind.
 5. Dem Vorschlag für ein Chip-Gesetz ist ein Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2085 zur Gründung der Gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ (des sogenannten „einheitlichen Basisrechtsakts“) hinsichtlich des Gemeinsamen Unternehmens für Chips² beigefügt, um die meisten der im Rahmen der Initiative „Chips für Europa“ vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen.
 6. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des Europäischen Parlaments hat Herrn Dan NICA (S&D, RO) zum Berichterstatter über den Vorschlag für ein Chip-Gesetz ernannt. Der ITRE-Ausschuss wird voraussichtlich im Januar 2023 über seine Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag abstimmen und das Verhandlungsmandat annehmen, über das im Februar 2023 im Plenum abgestimmt werden soll.
 7. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme zu dem Vorschlag für ein Chip-Gesetz am 15. Juni 2022 angenommen.³ Die vom Europäischen Ausschuss der Regionen erbetene Stellungnahme wurde am 12. Oktober 2022 angenommen.⁴

² Dok. 6171/22.

³ Dok. 10439/22.

⁴ Dok. 14222/22.

II. BERATUNGEN IM RAT

8. Der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) hörte auf seiner Tagung vom 24. Februar 2022 eine Präsentation der Kommission zu Inhalt und Ziel des vorgeschlagenen Chip-Gesetzes. Er nahm die erzielten Fortschritte zur Kenntnis und führte auf seiner Tagung vom 9. Juni 2022 eine Orientierungsaussprache über den Kommissionsvorschlag.
9. Die Gruppe „Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum“ (Industrie) begann im Februar 2022 unter französischem Vorsitz anhand einer Präsentation des Vorschlags durch die Kommission mit der Prüfung des Vorschlags. In zehn Sitzungen der Gruppe wurden der Kommissionsvorschlag und ein vom französischen Vorsitz ausgearbeiteter erster Kompromisstext eingehend geprüft.
10. Die Beratungen wurden unter tschechischem Vorsitz auf der Grundlage vom tschechischem Vorsitz ausgearbeiteter überarbeiteter Kompromisstexte in den Sitzungen der Gruppe vom 8. und 15. Juli, vom 5., 12., 19. und 26. September, vom 6., 10., 19. und 24. Oktober sowie vom 9. November 2022 fortgesetzt.
11. Zwar begrüßten die Delegationen den Vorschlag im Allgemeinen und unterstützten seine Ziele, doch gingen ihre Ansichten darüber auseinander, wie diese Ziele am besten erreicht werden können. Daher hat der Vorsitz zwar den Grundgedanken, den Inhalt und die Grundstruktur des vorgeschlagenen Rechtsakts beibehalten, jedoch mehrere Bestimmungen des Kommissionsvorschlags in seinen aufeinanderfolgenden überarbeiteten Kompromisstexten geändert, um den Anliegen der Delegationen während der Beratungen auf Gruppenebene Rechnung zu tragen, die Klarheit und Durchführbarkeit des Vorschlags zu verbessern und für Rechtssicherheit zu sorgen.

Dabei ging es insbesondere um folgende Fragen:

- die Definition einer „neuartigen“ Halbleiter-Fertigungsanlage, um klarzustellen, dass es sich bei dem ausschlaggebenden Merkmal um Innovation in vielen verschiedenen Dimensionen handeln kann;
- die Formulierung der allgemeinen und operativen Ziele und des Inhalts der Initiative „Chips für Europa“ sowie die Festlegung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten und Tätigkeiten zum Kapazitätsaufbau;

- die Harmonisierungskomponente des Chip-Gesetzes und das Ziel, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern;
- die Einrichtung eines europäischen Netzes von Kompetenzzentren für Halbleiter, Integrationstechnologien und Systementwurf;
- die Anforderungen an integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe, insbesondere im Hinblick auf positive Ausstrahlungseffekte auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union;
- die Rolle der Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Halbleitergremiums bei der Entscheidung über den Status einer integrierten Produktionsstätte oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs, auch im Fall einer Aufhebung;
- die Möglichkeit, bei Planung, Bau und Betrieb integrierter Produktionsstätten oder offener EU-Fertigungsbetriebe, die als von „überwiegendem öffentlichen Interesse“ angesehen werden, von umweltrechtlichen Verfahren abzuweichen;
- die Gestaltung der von der Kommission durchzuführenden obligatorischen Anforderungen von Auskünften in der Krisenstufe, einschließlich Garantien zur Gewährleistung ihrer Verhältnismäßigkeit und der Sicherheitsinteressen;
- den Umfang und die Umsetzung des Notfallinstrumentariums in Bezug auf die Liste kritischer Sektoren und die Instrumente der vorrangigen Aufträge und der gemeinsamen Beschaffung sowie das Vorsehen eines Durchführungsrechtsakts des Rates zur Auslösung der Krisenstufe;
- die Durchsetzung der Auskunftspflicht und der Erfüllung vorrangiger Aufträge durch Geldbußen und Sanktionen.

12. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter erörterte auf seiner Tagung vom 4. November 2022 die Finanzierung und Finanzarchitektur des Chip-Gesetzes sowie die Bestimmungen über das vorgeschlagene Konsortium für eine europäische Chip-Infrastruktur (ECIC) und gab Leitlinien für das weitere Vorgehen in diesen Fragen vor.

Zwar waren sich die Mitgliedstaaten generell einig, dass das Programm „Horizont Europa“ und das Programm „Digitales Europa“ die geeignetsten Programme zur Durchführung des Chip-Gesetzes sind und dass die finanziellen Zielvorgaben des Chip-Gesetzes im Verhältnis zum Kommissionsvorschlag bleiben sollte, doch lehnten die Delegationen den Rückgriff auf die Aufhebung von Mittelbindungen im Rahmen von Horizont Europa ab. Zugleich stellte der Vorsitz fest, dass eine knappe Mehrheit der Mitgliedstaaten die Beibehaltung des ECIC in dem Vorschlag befürwortet, allerdings mit weiteren Klarstellungen zum Verfahren, insbesondere im Hinblick auf seine Offenheit.

13. Der Vorsitz arbeitete daher einen weiteren überarbeiteten Kompromisstext⁵ aus, in dem der Rückgriff auf die Aufhebung von Mittelbindungen im Rahmen von Horizont Europa nicht mehr vorgesehen ist, um die bestehende interinstitutionelle Vereinbarung über den Mehrjährigen Finanzrahmen in Bezug auf die Aufhebung von Mittelbindungen einzuhalten, was zu einer Kürzung der Gesamtmittel aus dem Programm „Digitales Europa“ um den entsprechenden Betrag von 400 Mio. EUR führt. Im Gegenzug schlug der Vorsitz vor, den in ADD 1 zu diesem Vermerk wiedergegebenen Entwurf einer Erklärung des Rates zu billigen.

Außerdem griff der Vorsitz in dem überarbeiteten Text das Anliegen der Delegationen auf, eindeutig festzulegen, welche operativen Ziele aus welchem Teil des Programms finanziert werden.

Darüber hinaus schlug der Vorsitz weitere Klarstellungen zum freiwilligen Charakter der Einrichtung eines ECIC, zu seiner Offenheit für verschiedene Rechtsformen der Zusammenarbeit und andere Teilnehmer sowie zu seinen Regeln für die Auswahl von Vorschlägen für eine Finanzierung vor, die nicht auf einer bestimmten Rechtsform der Zusammenarbeit beruhen sollten. Der Rat der öffentlichen Körperschaften des Gemeinsamen Unternehmens für Chips sollte die Möglichkeit haben, die Offenheit eines ECIC zu überprüfen und erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen zu verlangen.

14. Auf seiner Tagung vom 23. November 2022 prüfte der Ausschuss der Ständigen Vertreter diesen Kompromisstext und kam überein, die im letzten Kompromissvorschlag vorgeschlagene Änderung in Bezug auf den Wortlaut in Erwägungsgrund 12 betreffend das Netz von Kompetenzzentren für Halbleiter rückgängig zu machen. Er kam ferner überein, einen neuen Erwägungsgrund 15a aufzunehmen, um die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Forschung und Innovation aus Tätigkeiten zum Kapazitätsaufbau deutlicher herauszustellen.

⁵ Dok. 14454/22.

Alle Mitgliedstaaten konnten den Kompromisstext in der geänderten Fassung unterstützen. Der Vorsitz kam zu dem Schluss, dass dieser Text in der geänderten Fassung eine solide Grundlage für die Festlegung einer allgemeinen Ausrichtung auf der Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) am 1. Dezember 2022 darstellt.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter empfahl dem Rat ferner, die in ADD 1 zu diesem Vermerk wiedergegebene Erklärung zu billigen.

15. Der endgültige Kompromisstext ist in der ANLAGE zu diesen Vermerk wiedergegeben. Er spiegelt die anhaltenden Bemühungen des Vorsitzes und der Mitgliedstaaten wider, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Interessen und Zielen zu finden. Änderungen gegenüber dem vorherigen Text des Vorsitzes (Dok. 14454/22) sind in der englischen Fassung im Fall von Einfügungen durch **Fettdruck und Unterstreichung** und im Fall von Streichungen durch „[...]“ gekennzeichnet.

Die neuen Elemente in den Erwägungsgründen 15a und 16 sowie in Artikel 7 müssen in der Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2085 zur Gründung der Gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ hinsichtlich des Gemeinsamen Unternehmens für Chips nachvollzogen werden.

III. FAZIT

16. Der Rat wird ersucht,
 - übereinzukommen, auf der Grundlage des in der ANLAGE wiedergegebenen Kompromisstextes eine allgemeine Ausrichtung zum Kommissionsvorschlag festzulegen;
 - die in ADD 1 zu diesem Vermerk wiedergegebene Erklärung zu billigen, die dem Ratsprotokoll beigefügt wird.

Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

**zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-
Ökosystems (Chip-Gesetz)**

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf
Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses⁶,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen⁷,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

⁶ ABl. C vom , S. .

⁷ ABl. C vom , S. .

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Halbleiter sind ein zentraler Baustein aller digitalen Geräte, von Smartphones und Autos über kritische Anwendungen und Infrastrukturen in den Bereichen Gesundheit, Energie, Kommunikation und Automatisierung bis hin zu den meisten anderen Industriezweigen. Da Halbleiter für die digitale Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind, sind sie eine wichtige Triebfeder für die Nachhaltigkeitswende und tragen somit zu den Zielen des Grünen Deals bei. Halbleiter sind für das Funktionieren unserer modernen Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung – gleichwohl kommt es in der Union derzeit zu bisher unbekanntem Lieferunterbrechungen. Der gegenwärtige Versorgungsengpass ist ein Symptom für anhaltende und schwerwiegende strukturelle Mängel in der Halbleiter-Wertschöpfungs- und Lieferkette der Union. Die Liefermängel haben in dieser Hinsicht langfristige Schwachstellen zutage treten lassen, insbesondere eine starke Abhängigkeit von Drittländern bei der Chipentwicklung und -herstellung. Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung dafür, eine starke industrielle, wettbewerbsfähige und nachhaltige Basis in der Union zu erhalten, die Innovation in allen Bereichen der Chipindustrie fördert.
- (2) Es sollte ein Rahmen für die Stärkung der Resilienz der Union im Bereich der Halbleitertechnik geschaffen werden, durch den zum einen Investitionen stimuliert und die Kapazitäten der Halbleiter-Lieferkette der Union gestärkt werden und zum anderen die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission intensiviert wird.
- (3) Mit diesem Rahmen werden zwei Ziele verfolgt. Das erste Ziel besteht darin, die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Union zu schaffen und die Anpassung der Industrie an strukturelle Veränderungen sicherzustellen, die sich aus schnellen Innovationszyklen und Nachhaltigkeitserfordernissen ergeben. Ein zweites Ziel, das eigenständig ist und das erste Ziel ergänzt, besteht darin, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, indem ein einheitlicher EU-Rechtsrahmen zur Erhöhung der Resilienz und Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnik festgelegt wird, um die Robustheit gegenüber Störungen zu erhöhen.

- (4) Im Einklang mit Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags müssen Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems der Union ergriffen werden. Mit diesen Maßnahmen ist keine Harmonisierung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften verbunden. Die Union sollte in dieser Hinsicht die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der technologischen und industriellen Basis für Halbleiter erhöhen und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit des Halbleiter-Ökosystems stärken, die Abhängigkeit von einigen wenigen Drittländern und dort angesiedelten Unternehmen verringern und ihre Fähigkeit zur Entwicklung und Herstellung moderner Komponenten stärken. Die Initiative „Chips für Europa“ (im Folgenden die „Initiative“) sollte diese Ziele unterstützen, indem die Kluft zwischen den hoch entwickelten Forschungs- und Innovationskapazitäten Europas einerseits und deren nachhaltiger industrieller Nutzung andererseits überbrückt wird. Sie sollte den Kapazitätsaufbau unterstützen, um die Entwicklung, Produktion und Systemintegration bei den Halbleitertechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen, sowie die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren in der Union verbessern, die Liefer- und Wertschöpfungsketten für Halbleiter in Europa stärken, wichtige Industriezweige fördern und neue Märkte schaffen.

- (5) Aufgrund der Allgegenwart von Halbleitern haben sich die jüngsten Engpässe entweder direkt oder indirekt negativ auf Unternehmen in der gesamten Union ausgewirkt und starke wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen haben zu einem erhöhten Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Wirtschaftsakteure geführt und Druck auf die Mitgliedstaaten ausgeübt, die strategischen Abhängigkeiten in Bezug auf Halbleiter anzugehen. Zugleich ist der Halbleitersektor durch Interdependenzen entlang der Wertschöpfungskette gekennzeichnet, wobei keine einzelne Region alle Stufen der Wertschöpfungskette dominiert. Dieser grenzüberschreitende Charakter wird dadurch noch deutlicher, dass Halbleiterprodukte ein Wegbereiter für nachgelagerte Industrien sind. Während die Halbleiterherstellung in einigen Regionen konzentriert sein mag, sind die Nutzerindustrien über die gesamte Union verteilt. Vor diesem Hintergrund können die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems am besten durch Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union auf der Grundlage von Artikel 114 des Vertrags verbessert werden. Es bedarf eines einheitlichen, kohärenten Rechtsrahmens zur Harmonisierung bestimmter Bedingungen für Akteure zur Durchführung spezifischer Projekte, die zur Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen. Darüber hinaus sollte ein koordinierter Mechanismus für die Überwachung und Krisenreaktion eingerichtet werden, um Versorgungsengpässen entgegenzuwirken und Hindernisse für die Einheit des Binnenmarkts zu verhindern, wobei eine unterschiedliche Reaktion der Mitgliedstaaten zu vermeiden ist.
- (6) Die Verwirklichung dieser Ziele wird durch einen Governance-Mechanismus unterstützt. Durch diese Verordnung wird auf Unionsebene ein Europäisches Halbleitergremium (European Semiconductor Board) eingerichtet, das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem die Kommission den Vorsitz führt. Das Europäische Halbleitergremium wird die Kommission in spezifischen Fragen beraten und unterstützen, unter anderem bei der Durchführung dieser Verordnung, der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und dem Informationsaustausch zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Verordnung. Das Europäische Halbleitergremium sollte für seine im Rahmen der einzelnen Kapitel dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben gesonderte Sitzungen abhalten. In den Sitzungen können die hochrangigen Vertreter jeweils unterschiedlich zusammengesetzt sein, und die Kommission kann Untergruppen einsetzen.

- (7) Angesichts des globalisierten Charakters der Halbleiter-Lieferkette ist die internationale Zusammenarbeit mit Drittländern ein wichtiges Element, um das Halbleiter-Ökosystem der Union resilient zu machen. Die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen sollten die Union auch in die Lage versetzen, als Exzellenzzentrum eine stärkere Rolle in einem besser funktionierenden globalen, durch gegenseitige Abhängigkeiten geprägten Halbleiter-Ökosystem zu spielen. Die Kommission sollte mit Unterstützung des Europäischen Halbleitergremiums mit Drittländern zusammenarbeiten und Partnerschaften aufbauen, um nach Lösungen zu suchen, mit denen Unterbrechungen der Halbleiter-Lieferkette weitestgehend entgegengewirkt werden kann.
- (8) Kennzeichnend für den Halbleitersektor sind die sehr hohen Entwicklungs- und Innovationskosten sowie die sehr hohen Kosten für die Errichtung modernster Test- und Versuchsanlagen zur Unterstützung der industriellen Produktion. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit dieses Wirtschaftszweigs der Union sowie auf die Sicherheit der Versorgung und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems. Angesichts der Lehren aus den jüngsten Engpässen in der Union und weltweit sowie der raschen Entwicklung der technologischen Herausforderungen und der Innovationszyklen, die Auswirkungen auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette haben, ist es erforderlich, mittels dieser Initiative die Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Innovationsfähigkeit der Union zu stärken.
- (9) Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung für die Gewährleistung einer soliden Basis für Industrie, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in Europa. Gleichwohl machen Art und Umfang der Innovationsherausforderung bei Halbleitern eine Zusammenarbeit auf Unionsebene erforderlich.

[(10) gestrichen]

(11) Um die Union auf dem Gebiet der Halbleitertechnik mit den Forschungs- und Innovationskapazitäten auszustatten, die erforderlich sind, damit ihre Investitionen in Forschung und Industrie auf höchstem Niveau gehalten werden können, und um die derzeitige Kluft zwischen Forschung und Entwicklung einerseits und Produktion andererseits zu überbrücken, sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen besser koordinieren und gemeinsame Investitionen tätigen. Um dies zu erreichen, sollten die Union und die Mitgliedstaaten den Zielen des digitalen und ökologischen Wandels Rechnung tragen. Die Initiative sollte mit allen Bestandteilen und Maßnahmen zu einer möglichst weitgehenden Übertragung und Maximierung der Anwendungsvorteile von Halbleitertechnik führen, die die Nachhaltigkeitswende entscheidend vorantreiben und neue Produkte hervorbringen sowie eine effizientere, wirksamere, saubere und dauerhafte Nutzung von Ressourcen bewirken können, einschließlich Energie und Materialien, die für die Produktion und die Nutzung von Halbleitern über den gesamten Lebenszyklus erforderlich sind.

(12) Im Hinblick auf die Erreichung ihres allgemeinen Ziels und die Bewältigung der Herausforderungen sowohl auf der Angebots- wie auch der Nachfrageseite des derzeitigen Halbleiter-Ökosystems sollte die Initiative fünf operative Ziele beinhalten. Erstens sollte die Initiative Maßnahmen zum Aufbau einer virtuellen, unionsweit verfügbaren Entwurfsplattform unterstützen, um die Entwicklungskapazitäten in Europa zu stärken. Die Plattform sollte die Gemeinschaften von Entwurfsbetrieben, KMU und Start-ups, Urhebern und Werkzeuganbietern sowie Forschungs- und Technologieorganisationen zusammenbringen, um auf der Grundlage von gemeinsamer Technologieentwicklung virtuelle Prototyplösungen bereitzustellen. Zweitens sollte die Initiative, um die Grundlage für die Stärkung der Versorgungssicherheit und des Halbleiter-Ökosystems in der Union zu schaffen, den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer fortschrittlicher Pilotanlagen unterstützen, um die Entwicklung und den Einsatz von hochmodernen Halbleitertechnologien und Halbleitertechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen. Die Pilotanlagen sollten der Industrie Möglichkeiten bieten, Halbleitertechnologien und Systementwurfskonzepte bei möglichst geringer Umweltbelastung zu prüfen, zu erproben und zu validieren. Sind solche Möglichkeiten in der Union nicht gegeben und werden dadurch das Innovationspotenzial und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Union beeinträchtigt, so muss die Union zusammen mit den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor in Pilotanlagen investieren, um den bestehenden Strukturproblemen und dem Marktversagen entgegenzuwirken. Drittens sollten zur Beschleunigung der innovativen Entwicklung von Quantenchips und damit verbundenen Halbleitertechnologien, einschließlich solcher, die auf Halbleitermaterial basieren oder in Photonik integriert sind und der Entwicklung des Halbleitersektors dienen, im Rahmen der Initiative auch Maßnahmen in Bezug auf Entwurfsbibliotheken für Quantenchips, Pilotanlagen für die Herstellung von Quantenchips sowie Test- und Versuchseinrichtungen für die in den Pilotanlagen hergestellten Quantenchips unterstützt werden. Viertens sollte die Initiative durch den Ausbau bestehender oder die Schaffung neuer Einrichtungen die Gründung eines [...] Netzes von Kompetenzzentren für Halbleiter **in jedem Mitgliedstaat** unterstützen, um den Einsatz von Halbleitertechnologien zu fördern, den Zugang zu Entwicklungsstätten und Pilotanlagen zu ermöglichen und Qualifikationsdefizite in der gesamten Union zu überbrücken.

Der Zugang zu öffentlich finanzierter Infrastruktur wie Pilot- und Testanlagen sowie zum Netz der Kompetenzzentren sollte einem breiten Spektrum von Anwendern offenstehen und muss großen Unternehmen auf transparente Weise, diskriminierungsfrei und zu Marktbedingungen (oder auf Kostenbasis zuzüglich einer angemessenen Marge) gewährt werden, während KMU bevorzugten Zugang oder Preisnachlässe erhalten können. Ein solcher Zugang, auch für internationale Forschungs- und Geschäftspartner, kann die gegenseitige Bereicherung weiter fördern sowie Know-how und Exzellenz steigern und gleichzeitig zur Kostendeckung beitragen. Fünftens sollte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und gemeinsam mit anderen Durchführungspartnern wie Förderbanken und -instituten aus den Mitgliedstaaten eine spezielle Investitionsfazilität für Halbleiter einrichten (als Teil der unter dem Begriff „Chip-Fonds“ zusammengefassten Investitionsfördermaßnahmen), die sowohl Eigenkapitallösungen als auch Fremdfinanzierungen anbietet, einschließlich einer Mischfinanzierungsfazilität im Rahmen des durch die Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates⁸ eingerichteten Fonds „InvestEU“. Die Maßnahmen im Rahmen des „Chip-Fonds“ sollten die Entwicklung eines dynamischen und resilienten Halbleiter-Ökosystems unterstützen, indem Möglichkeiten für eine bessere Verfügbarkeit von Mitteln geschaffen werden, um das Wachstum von Start-ups und KMU sowie Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – auch für andere Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungsketten – zu unterstützen. Der Europäische Innovationsrat wird in dieser Hinsicht weitere gezielte Unterstützung in Form von Finanzhilfen und Beteiligungsinvestitionen zugunsten marktschaffender Innovatoren in Bereichen mit hohem Risiko leisten.

⁸ Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30).

- (13) Um die Einschränkungen aufgrund der derzeitigen fragmentierten Bemühungen um öffentliche und private Investitionen zu überwinden, die Integration und gegenseitige Bereicherung der laufenden Programme und deren Investitionserträge zu begünstigen sowie zur Verfolgung einer gemeinsamen strategischen Vision der Union in Bezug auf Halbleiter als Mittel zur Verwirklichung des Ziels der Union und ihrer Mitgliedstaaten, eine führende Rolle in der digitalen Wirtschaft zu spielen, sollte die Initiative „Chips für Europa“ eine bessere Koordinierung und engere Synergien zwischen den bestehenden Finanzierungsprogrammen auf Unions- und auf nationaler Ebene, eine bessere Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Industrie und wichtigen Akteuren des Privatsektors sowie zusätzliche gemeinsame Investitionen mit den Mitgliedstaaten erleichtern. Die Initiative ist so konzipiert, dass bei ihrer Umsetzung Ressourcen der Union, der Mitgliedstaaten und von an den bestehenden Unionsprogrammen beteiligten Drittländern sowie des Privatsektors gebündelt werden. Der Erfolg der Initiative kann daher nur auf gemeinsamen Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Union aufbauen, um sowohl die beträchtlichen Kapitalkosten mitzutragen als auch die breite Verfügbarkeit virtueller Entwurfs-, Test- und Pilotressourcen sowie die Verbreitung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen zu unterstützen. Angesichts des besonderen Charakters der betreffenden Maßnahmen sollten die Ziele der Initiative, insbesondere die Maßnahmen unter dem „Chip-Fonds“, gegebenenfalls auch durch eine Mischfinanzierungsfazität im Rahmen des Fonds „InvestEU“ gefördert werden.
- (14) Die Unterstützung im Rahmen der Initiative sollte genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen auf verhältnismäßige Weise auszugleichen, wobei die Maßnahmen weder private Finanzierung duplizieren oder verdrängen noch den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen sollten. Die Maßnahmen sollten einen klaren Mehrwert für die Union aufweisen.

- (14a) Mit der Umsetzung der Initiative sollte primär das Gemeinsame Unternehmen für Chips betraut werden, das mit der Verordnung XX/XX des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2085 zur Gründung der Gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ hinsichtlich des Gemeinsamen Unternehmen für Chips⁹ gegründet wurde.
- (15) Die Initiative sollte auf soliden Erkenntnissen aufbauen und Synergien mit Maßnahmen stärken, die derzeit von der Union und den Mitgliedstaaten durch Programme – insbesondere das mit der Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁰ eingerichtete Rahmenprogramm „Horizont Europa“ (Horizont Europa) und das mit der Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates¹¹ eingerichtete Programm „Digitales Europa“ – sowie durch Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Bereich der Halbleiter und der Entwicklung von Teilen der Lieferkette mit dem Ziel unterstützt werden, die Union bis 2030 als weltweiten Akteur auf dem Gebiet der Halbleitertechnik und ihrer Anwendungen zu stärken und ihren globalen Anteil an der Fertigung zu steigern. Ergänzend zu diesen Tätigkeiten gäbe es im Rahmen der Initiative auch eine enge Zusammenarbeit mit weiteren relevanten Akteuren, unter anderem der Allianz für Prozessoren und Halbleitertechnik.

⁹ [...]

¹⁰ Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).

¹¹ Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1).

(15a) Um Synergien zwischen den Programmen der Union und der Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sollte gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe k und Artikel 137 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates zur Gründung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“¹² in ihrer geänderten Fassung bei den Arbeitsprogrammen des Gemeinsamen Unternehmens für Chips im Rahmen der Initiative klar zwischen Maßnahmen zur Unterstützung von Forschung und Innovation im Halbleiterbereich und Maßnahmen zur Entwicklung von Teilen der Lieferkette unterschieden werden, damit eine angemessene Beteiligung öffentlicher und privater Einrichtungen gewährleistet ist.

¹² **Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Gründung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU) Nr. 559/2014, (EU) Nr. 560/2014, (EU) Nr. 561/2014 und (EU) Nr. 642/2014 (ABl. L 427 vom 30.11.2021, S. 17).**

(16) Um spezifische Maßnahmen der Initiative leichter durchführen zu können, wie etwa die Entwurfsplattform oder Pilotanlagen, muss ein neues Rechtsinstrument, das Konsortium für eine europäische Chip-Infrastruktur (ECIC), als Möglichkeit vorgesehen werden. Das ECIC sollte Rechtspersönlichkeit erhalten. Dies bedeutet, dass Finanzierungen spezifischer Maßnahmen im Rahmen der Initiative vom ECIC selbst und nicht von den einzelnen Einrichtungen, die ihm angehören, beantragt werden können. Gemäß Artikel XX der Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates zur Gründung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“^{[...]13} in ihrer geänderten Fassung sollten die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Arbeitsprogramms der Initiative „Chips für Europa“ jedoch für verschiedene rechtliche Formen der Zusammenarbeit und andere Teilnehmer offenstehen, und die Auswahl der Vorschläge für eine Finanzierung sollte nicht auf einer spezifischen rechtlichen Form der Zusammenarbeit beruhen. Hauptziel des ECIC sollte es sein, eine wirksame und strukturierte Zusammenarbeit zwischen Rechtsträgern, einschließlich Forschungs- und Technologieorganisationen, Industrie und Mitgliedstaaten, zu fördern. Das ECIC sollte aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Dabei kann es sich um Mitgliedstaaten, öffentliche oder private Rechtsträger aus mindestens drei Mitgliedstaaten oder eine Kombination davon handeln. Aufgrund seiner Rechtspersönlichkeit würde ein ECIC bei der Festlegung seiner Mitgliedschaft, Leitung, Finanzierung, Haushaltsbelange, Modalitäten für den Abruf der jeweiligen Finanzbeiträge seiner Mitglieder sowie Koordinierung, Verwaltung des geistigen Eigentums und Arbeitsweise über ausreichende Autonomie verfügen. Die Mitglieder des ECIC sollten bei der Festlegung des anwendbaren Rechts, des satzungsgemäßen Sitzes und der Stimmrechte über volle Flexibilität verfügen können.

13 [...]

Die Auswahl der öffentlichen und privaten Rechtsträger, die den Arbeitsplan des ECIC umsetzen, sollte fair, transparent und offen sein. Um einen fairen und gleichberechtigten Zugang zur Teilnahme zu gewährleisten, sollten ein ECIC während seiner gesamten Lebensdauer neuen Mitgliedern offenstehen, bei denen es sich um Mitgliedstaaten oder öffentliche oder private Rechtsträger handeln kann. Insbesondere sollten Mitgliedstaaten einem ECIC jederzeit als Vollmitglieder oder Beobachter beitreten können, während andere öffentliche oder private Rechtsträger jederzeit zu fairen und angemessenen Bedingungen, die in der Satzung festgelegt sind, beitreten können sollten. Der Rat der öffentlichen Körperschaften des gemeinsamen Unternehmens sollte in der Lage sein, die Offenheit eines ECIC zu überprüfen und erforderlichenfalls bestimmte Abhilfemaßnahmen zu verlangen. Die Schaffung eines ECIC sollte keine tatsächliche Gründung einer neuen Unionseinrichtung beinhalten. Vielmehr sollte die Lücke im EU-Instrumentarium geschlossen werden, damit Finanzmittel aus den Mitgliedstaaten, EU-Haushaltsmittel und private Investitionen zur Durchführung spezifischer Maßnahmen der Initiative miteinander kombiniert werden können. Die Kommission sollte dem Konsortium nicht unmittelbar angehören.

(16a) Ein ECIC, zu dessen Mitgliedern keine privaten Einrichtungen gehören, sollte als internationale Einrichtung im Sinne von Artikel 143 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates¹⁴ und im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/118/EG des Rates¹⁵ anerkannt werden. Ein ECIC, das private Einrichtungen zu seinen Mitgliedern zählt, darf nicht als solche internationale Einrichtung anerkannt werden.

[(17) in Erwägungsgrund 14a verschoben]

¹⁴ Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).

¹⁵ Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 12).

- (17a) Um den Zugang zu technischem Fachwissen zu erleichtern und die Verbreitung von Wissen in der gesamten Union sowie die Unterstützung verschiedener Qualifikationsinitiativen sicherzustellen, sollte ein Netz von Kompetenzzentren eingerichtet werden. Die Kompetenzzentren werden Dienstleistungen für die Halbleiterakteure, einschließlich Start-ups und KMU, erbringen. Beispiele hierfür sind die Erleichterung des Zugangs zu Pilotanlagen und zur Entwurfsplattform, die Bereitstellung von Schulungen und Kompetenzentwicklung, die Unterstützung bei der Suche nach Investoren, die Nutzung vorhandener lokaler Kompetenzen oder die Kontaktaufnahme zu den relevanten vertikalen Bereichen. Die Dienstleistungen sollten offen, transparent und diskriminierungsfrei erbracht werden. Jedes Kompetenzzentrum sollte mit dem europäischen Netz der Kompetenzzentren für Halbleiter verbunden sein, ihm angehören und als Zugangspunkt zu anderen Knotenpunkten des Netzes dienen. In diesem Zusammenhang sollten Synergien mit bestehenden ähnlichen Strukturen wie den Europäischen Digitalen Innovationszentren (EDIH) maximiert werden. So könnten die Mitgliedstaaten beispielsweise ein bestehendes EDIH mit Schwerpunkt auf Halbleitern für die Zwecke dieser Verordnung als Kompetenzzentrum benennen, solange nicht gegen das Verbot der Doppelfinanzierung verstoßen wird.
- (18) Um den Aufbau der erforderlichen Fertigungs- und entsprechenden Entwicklungskapazitäten zu unterstützen und damit die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems zu stärken und die Versorgungssicherheit in der Union sicherzustellen, kann eine öffentliche Förderung sinnvoll sein, sofern dies nicht zu Verzerrungen im Binnenmarkt führt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, bestimmte Bedingungen für die Durchführung spezifischer zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung beitragender Projekte durch Akteure auf Unionsebene zu harmonisieren und zwischen zwei Arten von Anlagen zu unterscheiden, nämlich integrierten Produktionsstätten und offenen EU-Fertigungsbetrieben. Das Unterscheidungsmerkmal für die Einstufung als eine der beiden Arten von Anlagen sollte das Geschäftsmodell sein. Offene EU-Fertigungsbetriebe bieten anderen Unternehmen Produktionskapazitäten an. Integrierte Produktionsstätten produzieren für ihre eigenen kommerziellen Zwecke und können neben der Herstellung auch andere Stufen der Lieferkette in ihr Geschäftsmodell integrieren, wie etwa Entwurf und Verkauf der Produkte.

- (19) Integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe sollten Fertigungskapazitäten für Halbleiter bieten, die in der Union neuartig sind und die zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems im Binnenmarkt beitragen. Der ausschlaggebende Faktor für „Neuartigkeit“ ist, dass damit ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das Endprodukt in den Binnenmarkt eingeführt wird, das auf neuen oder bestehenden Technologieknoten beruhen kann. Relevante Innovationselemente können der Technologieknoten oder das Trägermaterial sein oder in Ansätzen bestehen, die zu Verbesserungen bei der Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlässigkeit sowie zur Integration neuer Funktionen wie KI, Speicherkapazität oder anderer Funktionen führen. Die Integration verschiedener Prozesse, die zu Effizienzsteigerungen führen, oder die Automatisierung von Packaging und Montage sind ebenfalls Beispiele für Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile können innovative Elemente eine quantifizierbare Verringerung des Energie-, Wasser- oder Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Materialien umfassen. Die oben genannten Innovationselemente können sowohl für ausgereifte als auch für hochmoderne Technologieknoten gelten. Eine solche Innovation sollte im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden oder konkret geplant sein. Beispielsweise würden ähnliche Innovationen in der Forschung und Entwicklung oder in der Kleinmengenfertigung eine spätere Einstufung als „neuartig“ nicht zwangsläufig ausschließen.
- (20) Bietet ein offener EU-Fertigungsbetrieb von ihm unabhängigen Unternehmen Produktionskapazitäten an, sollte er eine angemessene und wirksame funktionale Trennung vornehmen, umsetzen und aufrechterhalten, um einen Austausch vertraulicher Informationen zwischen der internen und der externen Fertigung zu verhindern. Dies sollte für alle Informationen gelten, die in der Entwurfsphase und im Rahmen der Front-End- oder Back-End-Fertigungsprozesse gewonnen werden.

- (21) Voraussetzung für die Einstufung einer Anlage als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb sollte sein, dass Einrichtung, Betrieb oder Produktion der Anlage positive Ausstrahlungseffekte auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union haben, die sich positiv auf die Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union auswirken, die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte erhöhen und zum grünen und digitalen Wandel der Union beitragen. Für die Einstufung als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb können verschiedene Tätigkeiten in Betracht gezogen werden, die positive Ausstrahlungseffekte bewirken sollen. Beispiele hierfür sind die Gewährung des Zugangs zu Fertigungsanlagen gegen eine marktübliche Gebühr, die Bereitstellung von Process-Design-Kits für kleinere Entwurfsunternehmen oder für die Entwurfsplattform, die Verbreitung von Ergebnissen ihrer FuE-Tätigkeiten, die Forschungszusammenarbeit mit europäischen Universitäten und Forschungsinstituten, die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur Kompetenzentwicklung beizutragen, der Beitrag zu unionsweiten Forschungsprojekten oder das Angebot spezieller Unterstützungsmöglichkeiten für Start-ups und KMU. Auswirkungen, die sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in Bezug auf Kohäsionsziele, sollten als einer der Indikatoren für eindeutig positive Auswirkungen einer integrierten Produktionsstätte bzw. eines offenen EU-Fertigungsbetriebs auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette in der Union betrachtet werden.
- (22) Es ist wichtig, dass integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe nicht der extraterritorialen Anwendung von Gemeinwohlverpflichtungen unterliegen, die von Drittländern auferlegt werden und die ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, ihre Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermögenswerte, Ressourcen, ihr geistiges Eigentum oder ihr Know-how zu nutzen, die bzw. das sie zur Erfüllung der Verpflichtung benötigen, vorrangige Aufträge gemäß dieser Verordnung auszuführen, die sie garantieren müssten.

- (23) Angesichts der raschen Entwicklung der Halbleitertechnik und im Hinblick auf die Stärkung der künftigen industriellen Wettbewerbsfähigkeit der Union sollten integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe in der Union in kontinuierliche Innovation investieren, um konkrete Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund sollten integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe in der Lage sein, neue Entwicklungen zu testen und zu erproben, und zwar dank ihres bevorzugten Zugangs zu den Pilotanlagen der Initiative „Chips für Europa“, der durch im Schnellverfahren bearbeitete Anträge auf ihre Dienste gewährt wird und den effektiven Zugang anderer unberührt lässt.
- (24) Um ein einheitliches und transparentes Verfahren für die Erlangung des Status einer integrierten Produktionsstätte und eines offenen EU-Fertigungsbetriebs zu ermöglichen, sollte die Kommission den Beschluss über die Zuerkennung dieses Status jeweils auf Antrag einzelner Unternehmen oder von Unternehmenskonsortien erlassen. Der Status sollte sowohl für die Errichtung einer neuen Halbleiter-Fertigungsanlage als auch für die erhebliche Vergrößerung oder innovative Umgestaltung einer bestehenden Halbleiter-Fertigungsanlage gelten. Um der Bedeutung einer koordinierten und kooperativen Durchführung der geplanten Anlage Rechnung zu tragen, sollte die Kommission bei ihrer Bewertung die Bereitschaft des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, in dem/denen der Antragsteller seine Anlage einzurichten beabsichtigt, berücksichtigen, diese Einrichtung zu unterstützen. Darüber hinaus könnte die Kommission bei der Beurteilung der Tragfähigkeit des Geschäftsplans die Gesamtergebnisse des Antragstellers berücksichtigen.

- (24a) Angesichts der mit der Anerkennung als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb verbundenen Rechte sollte die Kommission überwachen, ob Anlagen, denen dieser Status zuerkannt wurde, die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen weiterhin erfüllen. Ist dies nicht mehr der Fall, so sollte die Kommission das Recht haben, den Status und die damit verbundenen Rechte zu überprüfen und erforderlichenfalls aufzuheben. Eine Entscheidung über die Aufhebung des Status sollte nur nach Anhörung des Europäischen Halbleitergremiums auf der Grundlage entsprechender Gründe getroffen werden. Dementsprechend sollte das Unternehmen, das eine integrierte Produktionsstätte oder einen offenen EU-Fertigungsbetrieb betreibt, die Möglichkeit haben, proaktiv eine Überprüfung der Dauer des Status oder der Durchführungspläne zu beantragen, wenn unvorhergesehene äußere Umstände, wie etwa schwerwiegende Störungen mit unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die anerkannte Anlage, Auswirkungen auf seine Fähigkeit haben könnten, die Kriterien zu erfüllen. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die meisten Rechte in der Gründungsphase gewährt werden, sollten Anlagen auch im Falle einer Aufhebung des Status für die verbleibende Zeit bis zum ursprünglich vorgesehenen Ablauf des Status der Verpflichtung zur Erfüllung vorrangiger Aufträge unterliegen.
- (25) Angesichts ihrer Bedeutung für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und die Schaffung eines resilienten Halbleiter-Ökosystems sollten integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe als im Interesse der Union stehend betrachtet werden. Die Gewährleistung der Halbleiterversorgungssicherheit ist auch für die Digitalisierung wichtig, die den grünen Wandel in vielen anderen Sektoren ermöglicht. Um zur Sicherheit der Halbleiterversorgung in der Union beizutragen, können die Mitgliedstaaten Unterstützungsmaßnahmen anwenden und administrative Unterstützung über nationale Genehmigungsverfahren vorsehen. Die Zuständigkeit der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 des Vertrags bleibt hiervon unberührt. Die Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe im Einklang mit dem Unionsrecht unterstützen.

- (26) Es ist notwendig, dass integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe so schnell wie möglich eingerichtet werden, wobei der Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu beschränken ist. Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten Anträge im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe so zügig wie möglich bearbeiten. Sie können eine Behörde benennen, die die Genehmigungsverfahren erleichtert und koordiniert sowie einen Koordinator benennen kann, der als zentrale Anlaufstelle für das Projekt fungiert. Zudem können, soweit dies für die Gewährung von Ausnahmen nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates¹⁶ und der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁷ erforderlich ist, die Einrichtung und der Betrieb dieser Anlagen als von überwiegendem öffentlichen Interesse im Sinne der genannten Rechtstexte betrachtet werden, sofern die übrigen in diesen Bestimmungen festgelegten Bedingungen erfüllt sind.
- (27) Für den Binnenmarkt wären gemeinsame Normen für grüne, vertrauenswürdige und sichere Chips von großem Nutzen. Künftige intelligente Geräte, Systeme und Vernetzungsplattformen werden sich auf fortgeschrittene Halbleiterchips stützen und in Bezug auf Umweltverträglichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Cybersicherheit Anforderungen erfüllen müssen, die weitgehend von den Merkmalen der zugrunde liegenden Technik abhängen werden. Zu diesem Zweck sollte die Union Referenzverfahren für die Zertifizierung entwickeln und die Industrie verpflichten, solche Verfahren für bestimmte Sektoren und Techniken mit potenziell hoher sozialer Wirkung gemeinsam zu entwickeln.
- (28) Vor diesem Hintergrund sollte die Kommission in Absprache mit dem Europäischen Halbleitergremium und unter gebührender Einbeziehung der Interessenträger den Weg für die Zertifizierung grüner, vertrauenswürdiger und sicherer Chips und eingebetteter Systeme ebnen, die auf Halbleitertechnik beruhen oder diese umfassend nutzen. Insbesondere sollten sie die relevanten Sektoren und Produkte, die einer solchen Zertifizierung bedürfen, erörtern und ermitteln.

¹⁶ Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

¹⁷ Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

- (29) Angesichts der strukturellen Mängel der Halbleiter-Lieferkette und des sich daraus ergebenden Risikos künftiger Engpässe sieht diese Verordnung Instrumente für einen koordinierten Ansatz zur Überwachung der Halbleiter-Wertschöpfungskette und zur wirksamen und verhältnismäßigen Bewältigung möglicher Marktstörungen vor.
- (30) Aufgrund der komplexen, sich rasch weiterentwickelnden und miteinander verflochtenen Halbleiter-Wertschöpfungsketten, an denen verschiedene Akteure beteiligt sind, ist ein koordinierter Ansatz für die regelmäßige Überwachung erforderlich, um die Fähigkeit zur Minderung von Risiken zu verbessern, die sich negativ auf die Versorgung mit Halbleitern auswirken können, und um das Verständnis der Dynamik der Halbleiter-Wertschöpfungsketten durch die Integration von Informationen zu verbessern. Die Kommission sollte die Halbleiter-Wertschöpfungskette in Absprache mit dem Europäischen Halbleitergremium überwachen und dabei den Schwerpunkt auf Frühwarnindikatoren legen, sodass diese Überwachung keinen übermäßigen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen darstellen würde.
- (30a) Um den Aufwand für die Unternehmen, an die sich die Überwachung richtet, so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass die erlangten Informationen sinnvoll zusammengestellt werden können, sollte die Kommission für jegliche Informationserhebung standardisierte Mittel vorsehen. Diese Mittel sollten gesichert sein und sicherstellen, dass alle erhobenen Informationen vertraulich behandelt werden.
- [(31) gestrichen]
- [(32) gestrichen]
- (33) Um diese Tätigkeiten zu ermöglichen, sollten die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten eine Kontaktliste aller relevanten innerhalb der Halbleiter-Lieferkette tätigen Unternehmen mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet erstellen, die es ermöglichen sollte, geeignete Adressaten für freiwillige Auskunftersuchen zu ermitteln, wobei diese Liste nicht vollständig sein muss. Die Kontaktliste sollte unter vollständiger Einhaltung der geltenden Vertraulichkeitsvorschriften behandelt werden.

[(34) gestrichen]

[(35) gestrichen]

[(36) gestrichen]

- (37) Um künftige Störungen in den verschiedenen Stufen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in der Union und des Handels innerhalb der Union vorherzusagen und entsprechend Vorsorge zu treffen, sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Halbleitergremium Frühwarnindikatoren im Rahmen der Risikobewertung der Union festlegen. Solche Indikatoren könnten sich beziehen auf atypische Verlängerungen der Vorlaufzeit, auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Humankapital, die für die Herstellung von Halbleitern benötigt werden, oder von geeigneten Produktionsausrüstungen, auf die prognostizierte Nachfrage nach Halbleitern auf dem Unionsmarkt und den Weltmärkten, auf Preissteigerungen, die über die normalen Preisschwankungen hinausgehen, Auswirkungen von Unfällen, Angriffen, Naturkatastrophen oder anderen schwerwiegenden Ereignissen, Auswirkungen handelspolitischer Maßnahmen, von Zöllen, Ausfuhrbeschränkungen, Handelshemmnissen und anderen handelsbezogenen Maßnahmen sowie auf die Auswirkungen von Unternehmensschließungen, Standortverlagerungen oder Übernahmen wichtiger Marktteilnehmer. Die Überwachungstätigkeiten der Kommission sollten sich auf diese Frühwarnindikatoren konzentrieren.
- (38) Es ist davon auszugehen, dass eine Reihe von Unternehmen, die Halbleiterdienstleistungen oder -waren anbieten, angesichts der Anzahl der Unternehmen in der Union, die auf ihre Waren angewiesen sind, ihres Anteils am Unions- oder Weltmarkt, ihrer Bedeutung für die Gewährleistung eines ausreichenden Angebots oder der möglichen Auswirkungen einer Störung der Versorgung mit ihren Waren oder Dienstleistungen, als für eine wirksame Halbleiter-Lieferkette im Halbleiter-Ökosystem der Union von wesentlicher Bedeutung einzuschätzen sind. Die Mitgliedstaaten sollten in Zusammenarbeit mit der Kommission die wichtigen Marktakteure in ihrem Hoheitsgebiet ermitteln.

- (39) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/452 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union¹⁸ können die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der Feststellung, ob eine ausländische Direktinvestition die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt, ihre potenziellen Auswirkungen auf kritische Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungszweck im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates¹⁹, einschließlich Halbleiter, berücksichtigen.
- (40) Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere die Integrität der von wichtigen Marktakteuren durchgeführten Tätigkeiten berücksichtigen. Solche Aspekte könnten dem Europäischen Halbleitergremium von dem betreffenden Mitgliedstaat zur Kenntnis gebracht werden.
- (40a) Um potenzielle Engpässe antizipieren zu können, sollten die zuständigen nationalen Behörden die Kommission warnen, wenn sie Kenntnis von der Gefahr einer schwerwiegenden Störung der Versorgung mit Halbleitern erlangen. Um ein koordiniertes Vorgehen zu gewährleisten, sollte die Kommission in Fällen, in denen sie von der Gefahr einer schwerwiegenden Störung der Versorgung mit Halbleitern erfährt, auch aufgrund von Informationen internationaler Partner, eine außerordentliche Sitzung des Europäischen Halbleitergremiums einberufen, um die Schwere der Störungen zu erörtern und zu prüfen, ob es angemessen, notwendig und verhältnismäßig sein könnte, dass die Mitgliedstaaten als Präventivmaßnahme eine koordinierte gemeinsame Beschaffung durchführen, sowie in einen Dialog mit Interessenträgern zu treten, um Präventivmaßnahmen zu ermitteln und vorzubereiten. Das Europäische Halbleitergremium und die Kommission sollten im Rahmen dieses Dialogs die Ansichten von Wirtschaftsakteuren und Interessenträgern der Halbleiter-Wertschöpfungskette berücksichtigen. Die Kommission sollte Konsultationen und eine Zusammenarbeit mit betreffenden Drittländern aufnehmen, um Störungen in der internationalen Lieferkette im Einklang mit internationalen Verpflichtungen und unbeschadet der verfahrensrechtlichen Vorschriften zu bewältigen.

¹⁸ Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union (ABl. L 79I vom 21.3.2019, S. 1).

¹⁹ Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).

- (41) Zu diesem Zweck sollte die Kommission in Fällen, in denen sie Kenntnis von der Gefahr einer schwerwiegenden Störung der Versorgung mit Halbleitern erlangt, eine Bewertung dieser Gefahren vornehmen. Ergibt diese Bewertung konkrete, ernsthafte und zuverlässige Belege für schwerwiegende Störungen der Versorgung mit Halbleitern oder schwerwiegenden Hindernisse für den Handel mit Halbleitern innerhalb der Union, die zu erheblichen Engpässen führen, welche die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher Produkte, die von kritischen Sektoren verwendet werden, wie medizinische und diagnostische Ausrüstung, verhindern, so sollte die Kommission dem Rat einen Vorschlag zur Aktivierung der Krisenstufe vorlegen können. Die Kommission sollte unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Halbleitergremiums und der Rückmeldungen von Wirtschaftsakteuren und Interessenträgern der Halbleiter-Wertschöpfungskette prüfen, ob die Krisenstufe verlängert werden sollte, und, sofern die Notwendigkeit einer Verlängerung festgestellt wird, die Krisenstufe um einen im Voraus festgelegten Zeitraum verlängern, und sie sollte dem Rat einen Vorschlag zur Verlängerung der Krisenstufe vorlegen können. Ebenso sollte die Kommission eine vorzeitige Beendigung der Krisenstufe prüfen und gegebenenfalls nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums ein solches Verfahren einleiten.
- (41a) Aufgrund des politisch sensiblen Charakters der Aktivierung der Krisenstufe und der möglichen Maßnahmen, die als Reaktion darauf ergriffen werden können, einschließlich der erheblichen Auswirkungen, die solche Maßnahmen auf private Unternehmen in der Union haben könnten, sollte dem Rat die Befugnis übertragen werden, in einer Halbleiterkrise einen Durchführungsrechtsakt über die Aktivierung, Verlängerung und Beendigung der Krisenstufe zu erlassen.

[(42) gestrichen]

[(43) gestrichen]

- (44) In der Krisenstufe sind eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten und die Koordinierung aller nationalen Maßnahmen, die in Bezug auf die Halbleiter-Lieferkette ergriffen werden, unerlässlich, um Störungen mit der erforderlichen Kohärenz, Resilienz und Wirksamkeit zu bewältigen. Zu diesem Zweck sollte das Europäische Halbleitergremium bei Bedarf außerordentliche Sitzungen abhalten. Alle Maßnahmen, die ergriffen werden, sollten strikt auf die Dauer der Krisenstufe beschränkt sein.
- (45) Für eine rasche, effiziente und koordinierte Reaktion der Union auf eine Halbleiterkrise ist es erforderlich, den Entscheidungsträgern rechtzeitig aktuelle Informationen über den Verlauf der operativen Situation zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass wirksame Maßnahmen ergriffen werden können, um die Versorgung der betroffenen kritischen Sektoren mit Halbleitern zu sichern. Bei Aktivierung der Krisenstufe sollten geeignete, wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden, unbeschadet einer etwaigen Fortsetzung der internationalen Zusammenarbeit mit den einschlägigen Partnern im Hinblick auf die Abmilderung der sich wandelnden Krisensituation. Darüber hinaus kann das Europäische Halbleitergremium in Bezug auf die Notwendigkeit der Einführung von Schutzmaßnahmen gemäß der Verordnung (EU) 2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates²⁰ Empfehlungen abgeben. Die Anwendung aller Notmaßnahmen sollte verhältnismäßig und auf das zur Behebung der erheblichen Störungen erforderliche Maß beschränkt sein, sofern dies im besten Interesse der Union liegt. Die Kommission sollte das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen und die entsprechenden Gründe unterrichten. Die Kommission kann nach Konsultation des Gremiums weitere Leitlinien für die Durchführung und Anwendung der Notmaßnahmen herausgeben.

²⁰ Verordnung (EU) 2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2015 über eine gemeinsame Ausfuhrregelung (ABl. L 83 vom 27.3.2015, S. 34).

(46) Eine Reihe von Sektoren ist für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts von kritischer Bedeutung. Bei diesen kritischen Sektoren handelt es sich um diejenigen, die im Anhang der Richtlinie (EU) Nr. .../... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Resilienz kritischer Einrichtungen²¹ in der am ... geltenden Fassung aufgeführt sind. Für die Zwecke dieser Verordnung sollten auch der Verteidigungssektor und die Gefahrenabwehr als kritische Sektoren betrachtet werden. Vorrangige Aufträge und gemeinsame Beschaffungen sollten nur eingesetzt werden, um die Versorgung kritischer Sektoren zu sichern. Die Kommission kann die Notmaßnahmen auf bestimmte dieser Sektoren oder auf bestimmte Teile davon beschränken, wenn die Halbleiterkrise deren Betrieb stört oder zu stören droht.

²¹ Richtlinie (EU) Nr. .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über die Resilienz kritischer Einrichtungen (ABl. L ... vom ..., S. ...).

(47) Der Zweck der Anforderung von Auskünften von in der Union niedergelassenen Unternehmen entlang der Halbleiter-Lieferkette in der Krisenstufe ist die Ermöglichung genauer Bewertungen der Halbleiterkrise oder die Ermittlung und Vorbereitung möglicher Gegen- oder Notmaßnahmen auf Unionsebene oder nationaler Ebene. Das kann Informationen über das Produktionsvermögen, die Produktionskapazität und die derzeitigen Hauptstörungen und Engpässe betreffen. Ferner könnte das die folgenden Aspekte einschließen: den typischen und aktuell tatsächlich vorhandenen Bestand an krisenrelevanten Produkten in den Produktionsanlagen der Unternehmen in der Union und Anlagen in Drittländern, die sie betreiben, denen sie Aufträge erteilen oder von denen sie Lieferungen beziehen; die typische und aktuelle durchschnittliche Vorlaufzeit für die gängigsten hergestellten Produkte; die erwartete Produktionsleistung für die folgenden drei Monate für jede Produktionsanlage in der Union; Gründe, die die Ausschöpfung von Produktionskapazitäten verhindern. Solche Auskünfte sollten sich auf das beschränken, was erforderlich ist, um die Art der Halbleiterkrise oder mögliche Gegen- oder Notmaßnahmen auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten zu bewerten. Auskunftersuchen sollten nicht zur Erteilung von Auskünften führen, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten zuwiderläuft. Die konkreten Informationen, die erfragt werden sollen, sollten in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Halbleitergremium auf der Grundlage einer vorherigen Stellungnahme einer repräsentativen Zahl einschlägiger Unternehmen im Rahmen einer freiwilligen Konsultation entwickelt werden. Jede Anforderung von Auskünften sollte verhältnismäßig sein, den rechtmäßigen Zielen des Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand der Bereitstellung der Daten Rechnung tragen und angemessene Fristen für die Bereitstellung der angeforderten Informationen vorsehen. Unternehmen sollten verpflichtet sein, der Anforderung von Auskünften nachzukommen, und können mit Sanktionen belegt werden, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig der Anforderung nicht nachkommen oder unrichtige Angaben machen. Alle erlangten Informationen sollten ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und den Vertraulichkeitsvorschriften unterliegen. Um eine umfassende Einbeziehung der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, in denen das Unternehmen seine Produktionsstätte hat, sollte die Kommission der zuständigen nationalen Behörde unverzüglich eine Kopie des Auskunftersuchens übermitteln und die erlangten Informationen auf Ersuchen der zuständigen nationalen Behörde auf sicherem Wege weitergeben.

Geht bei einem Unternehmen eine Anforderung von Auskünften im Zusammenhang mit seiner Halbleitertätigkeit aus einem Drittland ein, so sollte das Unternehmen die Kommission davon in Kenntnis setzen, damit beurteilt werden kann, ob auch eine Anforderung von Auskünften durch die Kommission gerechtfertigt ist.

- (48) Als letztes Mittel, um sicherzustellen, dass die Betriebskontinuität kritischer Sektoren in Krisenzeiten gewährleistet bleibt, und nur dann, wenn dies für diesen Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist, könnten integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe von der Kommission dazu verpflichtet werden, Aufträge für krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln, die entweder direkt von kritischen Sektoren eingesetzt werden oder zur Herstellung von Geräten verwendet werden, welche von kritischen Sektoren genutzt werden. Potenzielle Begünstigte vorrangiger Aufträge sollten Einrichtungen aus kritischen Sektoren oder Unternehmen sein, die kritische Sektoren beliefern und deren Tätigkeiten aufgrund des Engpasses gestört sind oder gestört zu werden drohen. Um sicherzustellen, dass vorrangige Aufträge nur im Bedarfsfall verwendet werden, sollten sie auf Begünstigte beschränkt werden, die nicht in der Lage waren, die Auswirkungen des Engpasses zu verhindern, z. B. durch ihre Beschaffungsverfahren, und durch andere Mittel abzufedern, z. B. durch die Nutzung bestehender Lagerbestände. Diese Verpflichtung kann auch auf andere Unternehmen in Bezug auf ihre Halbleiteranlagen ausgeweitet werden, für die sie diese Möglichkeit im Rahmen des Erhalts öffentlicher Unterstützung akzeptiert haben, wenn diese öffentliche Unterstützung darauf abzielte, die Fähigkeit zur Steigerung der Produktionskapazität zu fördern. Die Entscheidung über vorrangige Aufträge sollte im Einklang mit allen in der Union für die Umstände des Falls geltenden rechtlichen Verpflichtungen getroffen werden. Die Verpflichtung zur Erfüllung vorrangiger Aufträge sollte jeder anderen Erfüllungsverpflichtung nach privatem oder öffentlichem Recht vorgehen, wobei den rechtmäßigen Zielen des betreffenden Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand jeder Änderung der Produktionsreihenfolge Rechnung getragen werden sollte. Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur Erfüllung vorrangiger Aufträge nicht nachkommen, können mit Sanktionen belegt werden.

- (49) Das betreffende Unternehmen sollte verpflichtet sein, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Um sicherzustellen, dass vorrangige Aufträge auf die Kapazitäten und das Produktionsportfolio der Anlage abgestimmt sind, sollte die Kommission der betreffenden Anlage die Gelegenheit geben, sich zur Durchführbarkeit und zu den Einzelheiten des vorrangigen Auftrags zu äußern. Die Kommission sollte den vorrangigen Auftrag nicht erteilen, wenn die Anlage den Auftrag auch bei vorrangiger Behandlung nicht erfüllen kann, sei es aufgrund unzureichenden Produktionsvermögens oder unzureichender Produktionskapazität, oder wenn das Produkt oder die Dienstleistung von der Anlage nicht bereitgestellt bzw. erbracht wird oder weil dies eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Härte für die Anlage darstellen würde.
- (49a) Um einen transparenten und klaren Rahmen für die Durchführung vorrangiger Aufträge zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, einen Durchführungsrechtsakt zu erlassen, in dem die praktischen und operativen Modalitäten festgelegt werden. Dieser Durchführungsrechtsakt sollte Vorkehrungen enthalten, mit denen sichergestellt wird, dass vorrangige Aufträge im Einklang mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit durchgeführt werden, z. B. einen Mechanismus, der bestehende Aufträge berücksichtigt, und einen Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass das Volumen vorrangiger Aufträge das notwendige Maß nicht überschreitet.
- (50) Sollte ein einzelnes in der Halbleiter-Lieferkette in der Union tätiges Unternehmen unter außergewöhnlichen Umständen von einem Drittland eine Aufforderung zur Erfüllung eines vorrangigen Auftrags erhalten, sollte das Unternehmen die Kommission über diese Aufforderung unterrichten, damit bewertet werden kann, ob die Kommission im Falle erheblicher Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in kritischen Sektoren und bei Einhaltung der anderen Anforderungen der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit unter den entsprechenden Umständen ebenfalls die Verpflichtung zur Erfüllung vorrangiger Aufträge auferlegen sollte.

- (51) Angesichts der Bedeutung, die der Gewährleistung der Versorgungssicherheit in kritischen Sektoren, die wesentliche gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen, zukommt, sollte die Einhaltung der Verpflichtung zur Erfüllung vorrangiger Aufträge keine Haftung für Schäden gegenüber Dritten aufgrund von Verstößen gegen vertragliche Pflichten nach sich ziehen, die sich aus der notwendigen vorübergehenden Änderung der Betriebsabläufe des betreffenden Herstellers ergeben können, und zwar insoweit, wie der Verstoß gegen vertragliche Pflichten für die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war. Unternehmen, die möglicherweise in den Anwendungsbereich vorrangiger Aufträge fallen, sollten diese Möglichkeit in den Bedingungen ihrer Geschäftsverträge vorwegnehmen. Unbeschadet der Anwendbarkeit anderer Bestimmungen bleibt die Haftung für fehlerhafte Produkte gemäß der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985²² von diesem Haftungsausschluss unberührt.
- (52) Die Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung bestimmter Produkte achtet den Wesensgehalt der unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit gemäß Artikel 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden die „Charta“) sowie des Eigentumsrechts gemäß Artikel 17 der Charta und wahrt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Jede Einschränkung dieser Rechte nach dieser Verordnung muss gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten sowie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren.

²² Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29).

- (53) Bei Aktivierung der Krisenstufe könnten zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Kommission das Mandat erteilen, die Nachfrage zu bündeln und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im öffentlichen Interesse im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Verfahren der Union in ihrem Namen zu handeln, um durch die Kaufkraft eine Hebelwirkung zu erzielen. Mit dem Mandat könnte die Kommission ermächtigt werden, Vereinbarungen über den Kauf krisenrelevanter Produkte zu schließen, die entweder direkt von kritischen Sektoren eingesetzt oder zur Herstellung von Geräten verwendet werden, welche von kritischen Sektoren genutzt werden. Die Kommission sollte in Absprache mit dem Gremium den Nutzen, die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit jedes Antrags prüfen. Beabsichtigt sie, dem Antrag nicht nachzukommen, so sollte sie dies den betroffenen Mitgliedstaaten und dem Gremium mitteilen und die Gründe für ihre Ablehnung nennen. Die Einzelheiten des Verfahrens sollten in einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den beteiligten Mitgliedstaaten festgelegt werden, die die Zahl der zu schließenden Verträge und die Bedingungen für die gemeinsame Beschaffung, wie etwa Preise, Lieferfristen, Mengen und Opt-in- oder Opt-out-Klauseln, umfassen kann. Die gemeinsame Beschaffung kann zur Unterzeichnung eines einzigen Vertrags, der den Bedarf aller Mitgliedstaaten deckt, oder mehrerer Verträge, die jeweils den Bedarf eines oder mehrerer Mitgliedstaaten decken, führen. Darüber hinaus sollten die beteiligten Mitgliedstaaten das Recht haben, Vertreter zu benennen, die das Beschaffungsverfahren und die Aushandlung der Beschaffungsverträge anleitend und beratend begleiten. Für die Einführung und Verwendung der beschafften Produkte sollten die beteiligten Mitgliedstaaten verantwortlich bleiben.
- (54) Während einer Krise infolge von Lieferengpässen bei Halbleitern könnte es notwendig werden, dass die Union Schutzmaßnahmen in Erwägung zieht. Das Europäische Halbleitergremium kann Stellung nehmen, um die Kommission bei ihrer Bewertung der Frage zu unterstützen, ob die Marktlage einen erheblichen Mangel an lebenswichtigen Gütern gemäß der Verordnung (EU) 2015/479 darstellt.

(55) Um eine reibungslose, wirksame und harmonisierte Durchführung dieser Verordnung, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu erleichtern, sollte das Europäische Halbleitergremium eingerichtet werden. Das Europäische Halbleitergremium sollte die Kommission in spezifischen Fragen beraten und unterstützen. Dies sollte Folgendes umfassen: die Beratung des Rates der öffentlichen Körperschaften des Gemeinsamen Unternehmens für Chips in Bezug auf die Initiative „Chips für Europa“; die Beratung der Kommission bei der Bewertung von Informationen über integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe; die Erörterung und Vorbereitung der Festlegung bestimmter Sektoren und Technologien mit potenziell hoher sozialer oder ökologischer Wirkung, für die daher eine Zertifizierung grüner, vertrauenswürdiger und sicherer Produkte nötig ist, sowie eine koordinierte Überwachung und Krisenreaktion. Ferner sollte das Europäische Halbleitergremium Ratschläge und Empfehlungen zur Durchführung dieser Verordnung erteilen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Informationsaustausch über Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung erleichtern. Das Europäische Halbleitergremium sollte die Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit, einschließlich der Einholung von Informationen und der Krisenbewertung, im Einklang mit internationalen Verpflichtungen unterstützen. Darüber hinaus sollte das Europäische Halbleitergremium die Koordinierung, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit andere Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen der Union gewährleisten, um für ein kohärentes und koordiniertes Vorgehen der Union in Bezug auf Krisenreaktions- und Krisenvorsorgemaßnahmen für Halbleiterkrisen zu sorgen.

- (56) Den Vorsitz im Europäischen Halbleitergremium sollte ein Vertreter der Kommission führen. Die einzelnen Mitgliedstaaten sollten jeweils mindestens einen hochrangigen Vertreter im Europäischen Halbleitergremium benennen. Sie könnten auch verschiedene Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben des Europäischen Halbleitergremiums benennen, z. B. je nachdem, welches Kapitel dieser Verordnung in den Sitzungen des Europäischen Halbleitergremiums erörtert wird. Um wichtige Ratschläge zu den Tätigkeiten des Europäischen Halbleitergremiums einzuholen und eine angemessene Beteiligung von Interessenträgern zu ermöglichen, kann der Vorsitz Untergruppen einsetzen und sollte befugt sein, Experten und Beobachter auf Ad-hoc-Basis zur Teilnahme an den Sitzungen einzuladen oder Interessenträger, insbesondere Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie der Union vertreten, wie die Industrieallianz für Prozessoren und Halbleitertechnik, als Beobachter in die Untergruppen bitten.
- (57) Das Europäische Halbleitergremium wird für seine Aufgaben nach Kapitel II sowie für seine Aufgaben nach den Kapiteln III und IV getrennte Sitzungen abhalten. Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit im Europäischen Halbleitergremium zu gewährleisten. Der Vorsitz sollte den Austausch zwischen dem Europäischen Halbleitergremium und anderen Einrichtungen, Ämtern, Agenturen und Beratungsgruppen der Union fördern können. Angesichts der Bedeutung der Versorgung mit Halbleitern für andere Sektoren und des sich daraus ergebenden Koordinierungsbedarfs sollte der Vorsitz dafür sorgen, dass andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union als Beobachter an den Sitzungen des Europäischen Halbleitergremiums teilnehmen, sofern dies im Zusammenhang mit dem Überwachungs- und Krisenreaktionsmechanismus gemäß Kapitel IV relevant und angemessen ist. Um die Arbeiten im Anschluss an die Umsetzung der Empfehlung der Kommission über ein gemeinsames Instrumentarium der Union zur Behebung von Lieferengpässen bei Halbleitern fortzusetzen und zu nutzen, sollte das Europäische Halbleitergremium die Aufgaben der europäischen Expertengruppe für Halbleiter übernehmen. Sobald das Europäische Halbleitergremium seine Arbeit aufgenommen hat, sollte diese Expertengruppe aufgelöst werden.

- (58) Den Mitgliedstaaten kommt bei der Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung eine Schlüsselrolle zu. In diesem Zusammenhang sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere zuständige nationale Behörden benennen, die die wirksame Umsetzung dieser Verordnung sicherstellen und dafür sorgen, dass diese Behörden über angemessene Befugnisse und Ressourcen verfügen. Die Mitgliedstaaten könnten eine oder mehrere bereits bestehende Behörden benennen. Um die Organisationseffizienz in den Mitgliedstaaten zu erhöhen und eine offizielle Anlaufstelle für die Öffentlichkeit und andere Partner auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union, einschließlich der Kommission und des Europäischen Halbleitergremiums, einzurichten, sollte jeder Mitgliedstaat innerhalb einer der von ihm gemäß dieser Verordnung als zuständig benannten Behörden eine nationale zentrale Anlaufstelle auswählen, die für die Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung und die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten zuständig ist.
- (59) Zur Gewährleistung einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit der zuständigen Behörden auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten sollten alle an der Anwendung dieser Verordnung beteiligten Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen der Durchführung ihrer Tätigkeiten erlangten Informationen und Daten wahren, sodass insbesondere die Rechte des geistigen Eigentums und sensible Geschäftsinformationen oder Betriebsgeheimnisse geschützt werden. Alle Informationen, die im Rahmen der Bewerbung als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb oder im Rahmen von Auskunftsersuchen oder Mitteilungspflichten gemäß dieser Verordnung erlangt werden, sollten ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und gemäß Artikel 339 des Vertrags sowie den internen Vorschriften der Kommission über den sicheren Umgang mit Daten, insbesondere dem Beschluss 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit in der Kommission²³, unter das Berufsgeheimnis fallen. Die Kommission und die zuständigen nationalen Behörden, ihre Beamten, Bediensteten und sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behörden tätig sind, sowie Beamte und Bedienstete anderer Behörden der Mitgliedstaaten sollten die Vertraulichkeit der bei der Durchführung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten erlangten Informationen gewährleisten. Dies sollte auch für das Europäische Halbleitergremium und den Halbleiterrausschuss gelten, die mit dieser Verordnung eingerichtet werden. Die Kommission sollte gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte erlassen können, um die praktischen Modalitäten der Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen der Einholung von Informationen festzulegen.

²³ ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41.

(60) Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte mittels Geldbußen und Zwangsgeldern durchsetzbar sein. Zu diesem Zweck sollten angemessene Geldbußen für die Missachtung von Auskunftersuchen und Mitteilungspflichten gemäß dieser Verordnung festgelegt werden, wobei die unterschiedliche Schwere der Missachtung beider Pflichten zu berücksichtigen ist und für KMU andere Höchstbeträge gelten sollten. Außerdem sollten Zwangsgelder für Verstöße gegen die Verpflichtung zur Annahme und Ausführung vorrangiger Aufträge festgelegt werden, die verhältnismäßig sein und das Preisniveau auf dem Markt während der letzten 90 Tage widerspiegeln sollten, wobei für KMU andere Höchstbeträge gelten sollten. Zusätzlich zu den Verjährungsfristen für die Vollstreckung von Sanktionen sollten auch Verjährungsfristen für die Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern gelten. Darüber hinaus sollte die Kommission dem betreffenden Unternehmen oder den entsprechenden Unternehmensverbänden Anspruch auf rechtliches Gehör einräumen.

[(61) gestrichen]

(62) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission im Zusammenhang mit der Auswahl von Konsortien für eine europäische Chip-Infrastruktur Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit die Ziele der Initiative verwirklicht werden können. Darüber hinaus sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Festlegung der praktischen und operativen Modalitäten für die Funktionsweise vorrangiger Aufträge sowie auf die Festlegung der praktischen Modalitäten der Behandlung vertraulicher Informationen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates²⁴ ausgeübt werden.

²⁴ Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

(63) Da das Ziel dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem im selben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Ziele

- (1) Diese Verordnung schafft einen Rahmen für die Stärkung des Halbleiter-Ökosystems auf Unionsebene insbesondere durch folgende Maßnahmen:
 - a) Einrichtung der Initiative „Chips für Europa“ (im Folgenden die „Initiative“);
 - b) Festlegung der Kriterien für die Anerkennung und Unterstützung neuartiger integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe, die die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union fördern;
 - c) Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zur Überwachung der Versorgung mit Halbleitern und der Krisenreaktion bei Halbleiterknappheit.
- (2) Das erste Ziel dieser Verordnung besteht darin, die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Union zu schaffen und die Anpassung der Industrie an strukturelle Veränderungen sicherzustellen, die sich aus schnellen Innovationszyklen und Nachhaltigkeitserfordernissen ergeben.

Ein zweites Ziel, das eigenständig ist und das erste Ziel ergänzt, besteht darin, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, indem ein einheitlicher EU-Rechtsrahmen zur Erhöhung der Resilienz und Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnik festgelegt wird, um die Robustheit gegenüber Störungen zu erhöhen.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

- (1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. „Halbleiter“ hat eine der folgenden Bedeutungen:
 - a) ein einfacher Werkstoff oder ein Verbundwerkstoff, dessen elektrische Leitfähigkeit verändert werden kann, oder
 - b) eine Komponente, die aus mehreren Schichten halbleitender, isolierender und leitender Werkstoffe besteht, die nach einem vorbestimmten Muster festgelegt sind und genau definierte elektronische und/oder photonische Funktionen ausführen sollen;
 2. „Chip“ ist ein elektronisches Gerät, das auf einem einzigen Halbleiterwerkstoff verschiedene Funktionselemente gewöhnlich in Form von Speicher-, Logik-, Prozessor- und Analoggeräten enthält, auch als „integrierte Schaltung“ bezeichnet;
 - 2a. „Quantenchip“ ist ein Gerät, mit dem Informationen auf der Ebene einzelner Quantensysteme verarbeitet werden, wobei der Integrationsgrad der Komponenten auf einem einzigen Chip je nach verwendeter Quantenplattform, einschließlich Plattformen für Quanteninformatik, -kommunikation, -sensorik oder -metrologie, variiert;
 3. „Technologieknoten“ bezeichnet einen spezifischen Halbleiterfertigungsprozess und seine Entwurfsregeln;
 4. „Halbleiter-Lieferkette“ ist das System der Tätigkeiten, Organisationen, Akteure, Technologien, Informationen, Ressourcen und Dienstleistungen, die mit der Herstellung von Halbleitern verbunden sind, einschließlich Rohstoffen und verarbeiteten Werkstoffen, Fertigungsausrüstung, Entwurf, samt der damit verbundenen Softwareentwicklung, Herstellung, Montage, Prüfung und Packaging;

5. „Halbleiter-Wertschöpfungskette“ ist die Reihe der Tätigkeiten im Zusammenhang mit einem Halbleiterprodukt vom Entwurf bis zur Endverwendung, einschließlich Rohstoffen und verarbeiteten Werkstoffen, Fertigungsausrüstung, Forschung, Entwicklung und Innovation, Entwurf, Herstellung, Prüfung, Montage und Packaging bis hin zur Einbettung und Integration in Endprodukten und zu Verfahren am Ende der Lebensdauer wie Wiederverwendung, Zerlegung und Recycling;
6. „Pilotanlage“ ist ein Versuchsprojekt oder eine experimentelle Tätigkeit, das/die auf höhere Technologie-Reifegrade von 3 bis 8 abzielt, um eine unterstützende Infrastruktur weiterzuentwickeln, die notwendig ist, um ein Produkt oder System anhand der Modellannahmen zu testen, zu demonstrieren, zu validieren und zu kalibrieren;
- [7. gestrichen]
8. „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ sind kleine und mittlere Unternehmen im Sinne des Artikels 2 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission²⁵;
9. „Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung“ oder „Midcap-Unternehmen“ ist ein Unternehmen, bei dem es sich nicht um ein KMU handelt, mit bis zu 3 000 Beschäftigten, wobei die Mitarbeiterzahl nach den Artikeln 3 bis 6 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG berechnet wird;
- 9a. „kleines Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung“ ein Unternehmen, bei dem es sich nicht um ein KMU handelt und das bis zu 499 Beschäftigte hat, wobei sich die Mitarbeiterzahl nach Artikel 3 bis 6 des Anhangs an die Empfehlung 2003/361/EG berechnet;

²⁵ Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

10. „neuartige Anlage“ ist eine Halbleiter fertigende Industrieanlage, die eine Innovation in Bezug auf das Fertigungsverfahren oder Endprodukt bietet, die im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden ist oder deren Bau in der Union noch nicht konkret geplant ist; dies schließt unter anderem Innovationen ein, die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Sicherheitsniveaus, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlässigkeit oder der Energieeffizienz und Umweltbilanz oder des Technologieknotens oder Trägermaterials oder im Hinblick auf die Einführung von Produktionsverfahren, die Effizienzsteigerungen ermöglichen, betreffen;
11. „Chips der nächsten Generation“ und „Halbleitertechnik der nächsten Generation“ bezeichnen Chips und Halbleitertechnik, über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, da sie wesentliche Verbesserungen der Rechenleistung oder des Sicherheitsniveaus, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlässigkeit oder der Energieeffizienz und Umweltbilanz oder des Technologieknotens oder Trägermaterials oder im Hinblick auf die Einführung von Produktionsverfahren, die Effizienzsteigerungen ermöglichen, bieten;
 - 11a. „hochmoderne Halbleitertechnik“ bezeichnet den aktuellen Stand der Innovation bei Chips und Halbleitertechnik bei der Durchführung von Projekten;
 - 11b. „Fertigung von Halbleitern“ bezieht sich auf jedes der Stadien der Herstellung und Verarbeitung von Halbleiter-Wafern, einschließlich der Fertigung von Trägermaterial und Front-End und Back-End, die notwendig sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern;
12. „Front-End“ bezeichnet die gesamten Verfahrensabläufe für die Verarbeitung von Halbleiter-Wafern;
13. „Back-End“ bezeichnet das Packaging, die Montage und die Prüfung des Halbleiterprodukts;
14. „Abnehmer von Halbleitern“ ist ein Unternehmen, das Endprodukte herstellt, in die Halbleiter eingebaut sind;
15. „wichtige Marktakteure“ sind Unternehmen in der Halbleiter-Lieferkette der Union, deren zuverlässiges Funktionieren für die Lieferung von Halbleitern von wesentlicher Bedeutung ist;

16. „kritischer Sektor“ bezeichnet alle Sektoren, die im Anhang der Richtlinie (EU) Nr. .../...des Europäischen Parlaments und des Rates über die Resilienz kritischer Einrichtungen in der zum ... geltenden Fassung aufgeführt sind, sowie den Verteidigungs- und den Sicherheitssektor;
17. „krisenrelevantes Produkt“ bezeichnet Halbleiter, Zwischenprodukte und Rohstoffe, die für die Herstellung von Halbleitern oder Zwischenprodukten erforderlich sind und von einer Halbleiterkrise betroffen und für die Gewährleistung wesentlicher Funktionen eines kritischen Sektors relevant sind;
18. „Produktionsvermögen“ ist der mögliche Output einer Halbleiter-Fertigungsanlage bei optimalem Ressourceneinsatz;
19. „Produktionskapazität“ ist der Output einer Halbleiter-Fertigungsanlage.

KAPITEL II

INITIATIVE „CHIPS FÜR EUROPA“

ABSCHNITT 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 3

Einrichtung der Initiative

- (1) Die Initiative wird für die Laufzeit des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 eingerichtet.

- (2) Die Initiative wird mit Finanzmitteln des Programms „Horizont Europa“ und des Programms „Digitales Europa“ und insbesondere des spezifischen Ziels 6 in Höhe vorläufiger Richtbeträge von 1,65 Mrd. EUR bzw. 1,25 Mrd. EUR unterstützt. Die Verwendung dieser Mittel erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/695 und der Verordnung (EU) 2021/694.

Artikel 4

Ziele der Initiative

- (1) Das allgemeine Ziel der Initiative besteht darin, einen groß angelegten technologischen Kapazitätsaufbau und damit verbundene Forschungs- und Innovationstätigkeiten in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union zu unterstützen, um die Entwicklung und Einführung hochmoderner Halbleiter- und Quantentechnik der nächsten Generation zu ermöglichen, damit die fortgeschrittenen Fähigkeiten auf den Gebieten Entwurf, Systemintegration und Chip-Produktionsvermögen in der Union gestärkt werden. Die Initiative trägt zudem zur Verwirklichung des grünen und des digitalen Wandels bei, insbesondere durch die Verringerung der Klimaauswirkungen elektronischer Systeme, die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Chips der nächsten Generation, die Stärkung der Prozesse der Kreislaufwirtschaft und die Berücksichtigung des Grundsatzes der konzeptionsintegrierten Sicherheit, die vor Cybersicherheitsbedrohungen schützt.
- (2) Mit der Initiative werden die folgenden fünf operativen Ziele verfolgt:
- a) operatives Ziel 1: Aufbau groß angelegter hochentwickelter Entwurfskapazitäten für integrierte Halbleitertechnik;
 - b) operatives Ziel 2: Ausbau bestehender und Entwicklung neuer fortgeschrittener Pilotanlagen, um die Entwicklung und Einführung hochmoderner Halbleitertechnik der nächsten Generation zu ermöglichen;

- c) operatives Ziel 3: Aufbau fortgeschrittener technologischer und ingenieurtechnischer Kapazitäten zur Beschleunigung der innovativen Entwicklung von Quantenchips und dazugehöriger Halbleitertechnik;
 - d) operatives Ziel 4: Einrichtung eines unionsweiten Netzes der Kompetenzzentren durch den Ausbau bestehender oder die Schaffung neuer Einrichtungen;
 - e) operatives Ziel 5: Erleichterung des Zugangs insbesondere von Start-ups, Scale-ups, KMU und kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung in der Halbleiter-Wertschöpfungskette zur Fremd- und Beteiligungsfinanzierung durch eine Mischfinanzierungsfazilität des Fonds „InvestEU“ und über den Europäischen Innovationsrat (der „Chip-Fonds“).
- (3) Die in Absatz 2 aufgeführten operativen Ziele können Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten und damit verbundene Forschungs- und Innovationstätigkeiten umfassen. Alle Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten werden aus dem Programm „Digitales Europa“ und die damit verbundenen Forschungs- und Innovationstätigkeiten aus dem Programm „Horizont Europa“ finanziert.

Artikel 5

Inhalt der Initiative

- (1) Mit der Initiative wird Folgendes verfolgt:
- a) im Rahmen des operativen Ziels 1:
 - 1. Aufbau und Pflege einer unionsweit verfügbaren innovativen virtuellen Entwurfsplattform, die bestehende wie auch neue Entwurfsumgebungen mit erweiterten Bibliotheken und Werkzeugen für die elektronische Entwurfsautomatisierung (EDA) umfasst;

2. Ausbau der Entwurfsmöglichkeiten durch Förderung innovativer Entwicklungen, wie Prozessorarchitekturen, die auf quelloffenen Architekturen mit Befehlssatz (z. B. RISC-V) beruhen, Architekturen, die nach dem Grundsatz der konzeptionsintegrierten Sicherheit aufgebaut werden, und andere innovative Architekturen sowie neue Arten von Speichern, Prozessoren, Beschleunigern oder Chips mit niedrigem Energieverbrauch;
 3. Erweiterung des Halbleiter-Ökosystems durch Integration von Sektoren wie Gesundheit, Mobilität, Energie, Telekommunikation, Sicherheit, Verteidigung und Raumfahrt, um so zum angestrebten grünen und digitalen Wandel und zur angestrebten Innovation in der Union beizutragen;
- b) im Rahmen des operativen Ziels 2:
1. Stärkung der Fähigkeiten im Bereich der Chip-Fertigungstechnik der nächsten Generation durch die Einbeziehung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten und die Vorbereitung der Entwicklung künftiger Technologieknoten, wie Spitzenknotendichten unter 2 Nanometern, FD-SOI-Technik (Fully Depleted Silicon on Insulator) mit 10 Nanometern und darunter, neue Halbleitermaterialien oder Integration heterogener Systeme und fortschrittliche Modulmontage und fortschrittliches Packaging in großen, mittleren und kleinen Mengen;
 2. Unterstützung einer groß angelegten Innovation durch Zugang zu neuen oder bestehenden Pilotanlagen für Versuch, Erprobung, Validierung, Prüfung der Zuverlässigkeit des Endprodukts und Prozesssteuerung im Zusammenhang mit neuen Entwurfskonzepten zur Umsetzung von Schlüsselfunktionen wie neuartige Werkstoffe und Architekturen für die Leistungselektronik zur Förderung einer nachhaltigen Energienutzung und Elektromobilität, geringerer Energieverbrauch, Cybersicherheit, funktionale Sicherheit, höhere Rechenleistung oder Integration bahnbrechender Technik wie neuromorphe und eingebettete KI-Chips, integrierte Photonik, Graphen- und andere 2D-Materialtechnik und technische Lösungen für erhöhte Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit elektronischer Komponenten und Systeme;

3. Unterstützung integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe durch vorrangigen Zugang zu den neuen Pilotanlagen;
- c) im Rahmen des operativen Ziels 3:
1. Aufbau innovativer Entwurfsbibliotheken für Quantenchips;
 2. Unterstützung von Pilotanlagen für die Integration von Quantenschaltungen und Steuerelektronik;
 3. Entwicklung von Test- und Versuchseinrichtungen für die Erprobung und Validierung fortgeschrittener Quantenchips, die in den Pilotanlagen hergestellt werden;
- d) im Rahmen des operativen Ziels 4:
1. Stärkung der Kapazitäten und Bereitstellung eines breiten Spektrums an Fachwissen für alle Beteiligten, einschließlich als Endnutzer auftretender KMU und Start-up-Unternehmen, um den Zugang zu den genannten Kapazitäten und Einrichtungen und deren wirksame Nutzung zu erleichtern;
 2. Bewältigung des Fachkräftemangels und des Qualifikationsungleichgewichts durch Anziehung und Mobilisierung neuer Talente und Unterstützung der Heranbildung geeignet qualifizierter Arbeitskräfte zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems, unter anderem durch – neben Umschulung und Weiterbildung der Arbeitskräfte – die Bereitstellung geeigneter Ausbildungsmöglichkeiten für Studierende wie duale Studienprogramme und von Studienberatung;
- e) im Rahmen des operativen Ziels 5:
1. Verbesserung der Hebelwirkung des Einsatzes von Haushaltsmitteln der Union zu verbessern und Erzielung einer stärkeren Multiplikatorwirkung im Hinblick auf die Mobilisierung von Finanzmitteln des privaten Sektors;
 2. Unterstützung von Unternehmen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln haben, und Stärkung der notwendigen wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Union und ihrer Mitgliedstaaten;

3. Beschleunigung von Investitionen in den Bereichen Chip-Entwurf, Fertigung von Halbleitern und Intergrationstechnik zu beschleunigen sowie Mobilisierung von Finanzmitteln sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors und gleichzeitig Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette.

Artikel 5a

Umsetzung, Überwachung und Berichterstattung

- (1) Die operativen Ziele 1 bis 4 im Rahmen der Initiative werden auf das in der Verordnung XX/XX des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates genannte Gemeinsame Unternehmen für Chips übertragen und durch im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens für Chips festgelegte Maßnahmen umgesetzt.
- [(2) gestrichen]
- (3) Um eine wirksame Durchführung, Überwachung und Bewertung der Initiative zu gewährleisten, enthält der jährliche Tätigkeitsbericht des Gemeinsamen Unternehmens für Chips Informationen über Angelegenheiten im Zusammenhang mit den operativen Zielen 1 bis 4 auf der Grundlage der in Anhang II aufgeführten messbaren Indikatoren.
- (4) Die Kommission unterrichtet das Europäische Halbleitergremium regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung des operativen Ziels 5.

Artikel 6

Synergien mit Programmen der Union

- (1) Die Initiative ermöglicht Synergien mit Programmen der Union, wie in Anhang III beschrieben. Die Kommission stellt sicher, dass die Erreichung der Ziele bei der Durchführung der Initiative in Ergänzung zu Programmen der Union nicht behindert wird.

Artikel 7

Konsortium für eine europäische Chip-Infrastruktur

- (1) Zur Durchführung von Maßnahmen und anderer damit verbundener Aufgaben der Initiative, die über das Gemeinsame Unternehmen für Chips umgesetzt werden, kann unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen ein Rechtsträger in Form eines Konsortiums für eine europäische Chip-Infrastruktur (European Chips Infrastructure Consortium, im Folgenden „ECIC“) gegründet werden. Es kann unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen mehr als ein ECIC gegründet werden.
- (2) Ein ECIC
 - a) besitzt Rechtspersönlichkeit ab dem Tag des Inkrafttretens des in Absatz 6 genannten Beschlusses der Kommission;
 - aa) verfügt in jedem Mitgliedstaat über die weitest gehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dem Recht dieses Mitgliedstaats zuerkannt wird. Insbesondere kann es bewegliches und unbewegliches Vermögen sowie geistiges Eigentum erwerben, besitzen und veräußern, Verträge schließen und vor Gericht auftreten;
 - b) hat einen satzungsmäßigen Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats;
 - c) wird von mindestens drei Mitgliedern (Gründungsmitglieder) gegründet, die Mitgliedstaaten, öffentliche oder private Rechtsträger aus mindestens drei Mitgliedstaaten oder eine Kombination davon sein können;
 - ca) stellt sicher, dass nach dem Erlass eines Beschlusses zur Gründung eines ECIC andere Mitgliedstaaten jederzeit dem ECIC als Mitglieder beitreten können. Andere öffentliche oder private Rechtsträger können jederzeit zu fairen und angemessenen Bedingungen, die in der Satzung festgelegt sind, als Mitglieder beitreten. Mitgliedstaaten, die keinen finanziellen oder nichtfinanziellen Beitrag leisten, können dem ECIC durch Mitteilung an diesen als Beobachter ohne Stimmrecht beitreten;

- d) hat einen Koordinator.
- (3) Der Koordinator eines potenziellen ECIC stellt bei der Kommission im Namen aller Gründungsmitglieder einen schriftlichen Antrag, der Folgendes enthält:
- a) ein Ersuchen an die Kommission, ein ECIC zu gründen, mit einer Liste der Gründungsmitglieder;
 - b) den Entwurf der Satzung des ECIC, der zumindest Folgendes umfasst: die Dauer des Bestehens und das Verfahren zur Auflösung gemäß Artikel 7c; die Haftungsregelung gemäß Artikel 7a; den satzungsmäßigen Sitz und den Namen; den Anwendungsbereich; die Mitgliedschaft, einschließlich der Bedingungen und des Verfahrens für Änderungen der Mitgliedschaft; den Haushalt, einschließlich der Regelungen für die Inanspruchnahme der jeweiligen Finanzbeiträge und Sachleistungen seiner Mitglieder; das Eigentum an den Ergebnissen; die Leitung, einschließlich des Beschlussverfahrens und der besonderen Rolle und gegebenenfalls der Stimmrechte;
 - c) eine Erklärung des Aufnahmemitgliedstaats, ob er das ECIC ab dem Tag seiner Gründung als internationale Einrichtung im Sinne des Artikels 143 Buchstabe g und des Artikels 151 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates oder des Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/118/EG des Rates anerkennt. Die Grenzen und Bedingungen für die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Befreiungen werden in einer Vereinbarung zwischen den Mitgliedern des ECIC festgelegt.
- (4) Die Kommission prüft die Anträge anhand aller folgenden Kriterien:
- a) angemessene Kompetenzen, Fachkenntnisse und Fähigkeiten der vorgeschlagenen Gründungsmitglieder des ECIC in Bezug auf Halbleitertechnik und die Kompetenzen, Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die erworben, entwickelt oder dem vorgeschlagenen ECIC zugewiesen werden sollen;
 - b) vorgesehene Verwaltungskapazität, Personalstärke und Ressourcen, die für die Erfüllung des entsprechenden satzungsmäßigen Zwecks erforderlich sind;

- c) operative und rechtliche Mittel, um die auf Unionsebene festgelegten Bestimmungen für die Verwaltung sowie das Vertrags- und Finanzmanagement anzuwenden;
 - d) Finanzkraft, die der Höhe der Unionsmittel entspricht, mit deren Verwaltung es beauftragt werden soll, und die gegebenenfalls durch Rechnungslegungsunterlagen und Bankauszüge nachgewiesen wird;
 - e) Beiträge der ECIC-Mitglieder, die dem ECIC zur Verfügung gestellt würden, und die damit verbundenen Regelungen;
 - ea) Offenheit des ECIC für neue Mitglieder;
 - f) Fähigkeit des ECIC, den Bedürfnissen der Halbleiter-Wertschöpfungskette der EU gerecht zu werden.
- (5) Die Kommission erlässt auf der Grundlage der in Absatz 4 aufgeführten Kriterien einen Durchführungsrechtsakt, mit dem entweder der Antragsteller als ECIC anerkannt oder der Antrag abgelehnt wird, und teilt dies den Gründungsmitgliedern mit. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
- [(6) gestrichen]
- [(7) gestrichen]
- (8) Jede Änderung der Satzung wird der Kommission vom ECIC innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Annahme vorgelegt.
- (8a) Die Kommission kann gegen eine solche Änderung innerhalb von sechzig Tagen nach Vorlage Einwände erheben und die Gründe dafür angeben, weshalb die Änderung die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt.

- (8b) Die Änderung wird erst wirksam, wenn die Frist für die Erhebung von Einwänden abgelaufen ist oder von der Kommission aufgehoben wurde oder wenn etwaige Einwände zurückgezogen wurden.
- (8c) Der Antrag auf Änderung enthält Folgendes:
- a) den Wortlaut der vorgeschlagenen oder gegebenenfalls beschlossenen Änderung einschließlich des Datums ihres Inkrafttretens;
 - b) die geänderte, konsolidierte Fassung der Satzung.
- (9) Ein ECIC erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht, der eine technische Beschreibung seiner Tätigkeiten und einen Finanzbericht enthält. Der jährliche Tätigkeitsbericht wird der Kommission übermittelt und öffentlich zugänglich gemacht. Die Kommission kann Empfehlungen zu den im jährlichen Tätigkeitsbericht behandelten Angelegenheiten abgeben. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Halbleitergremium unverzüglich die jährlichen Tätigkeitsberichte des ECIC.
- (10) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass das ECIC sich weigert, ein neues Mitglied des Konsortiums aufzunehmen, ohne dies auf der Grundlage der in der Satzung festgelegten fairen und angemessenen Bedingungen angemessen zu begründen, so kann er die Angelegenheit dem Rat der öffentlichen Körperschaften des Gemeinsamen Unternehmens für Chips zur Kenntnis bringen, der gemäß Artikel XX der Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates zur Gründung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ (geänderte Fassung) gegebenenfalls verlangt, dass das ECIC Abhilfemaßnahmen wie eine Änderung der Satzung ergreift.

Artikel 7a

Haftung des ECIC

- (1) Ein ECIC haftet für seine Schulden.

- (2) Die finanzielle Haftung der Mitglieder für die Schulden des ECIC ist auf ihre jeweiligen Beiträge zum ECIC beschränkt. Die Mitglieder können in der Satzung festlegen, dass sie eine pauschale Haftung über ihre jeweiligen Beiträge hinaus oder eine unbeschränkte Haftung übernehmen.
- (3) Die Union haftet nicht für die Schulden eines ECIC.

Artikel 7b

Anwendbares Recht und Gerichtsstand des ECIC

- (1) Die Gründung und interne Funktionsweise eines ECIC unterliegen
 - a) dem Unionsrecht, insbesondere dieser Verordnung;
 - b) dem Recht des Staates, in dem das ECIC seinen satzungsmäßigen Sitz hat, in Angelegenheiten, die in den in Buchstabe a genannten Rechtsakten nicht oder nur teilweise geregelt sind;
 - c) der Satzung und ihren Durchführungsvorschriften.
- (2) Unbeschadet der Fälle, in denen der Gerichtshof der Europäischen Union nach den Verträgen zuständig ist, bestimmt sich die Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern des ECIC, zwischen den Mitgliedern und dem ECIC sowie zwischen dem ECIC und Dritten nach dem Recht des Staates, in dem das ECIC seinen satzungsmäßigen Sitz hat.

Artikel 7c

Auflösung des EIT

- (1) Das Verfahren für die Auflösung eines ECIC auf Beschluss seiner Mitglieder wird in der Satzung festgelegt.
- (2) Falls das ECIC nicht in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen, gelten die Insolvenzvorschriften des Staates, in dem das ECIC seinen satzungsmäßigen Sitz hat.

Artikel 8

Europäisches Netz der Kompetenzzentren für Halbleitertechnik

- (1) Für die Zwecke des operativen Ziels 4 der Initiative wird ein europäisches Netz der Kompetenzzentren für Halbleiter, Integrationstechnik und Systementwurf (im Folgenden das „Netz“) eingerichtet.
- (2) Die Kompetenzzentren führen zum Nutzen der Wirtschaft der Union, insbesondere der KMU und Midcap-Unternehmen, sowie von Forschungs- und Technologieorganisationen, der Hochschulen und des öffentlichen Sektors alle oder einige der folgenden Tätigkeiten durch:
 - a) Bereitstellung des Zugangs zu Entwurfsdienstleistungen und Entwurfswerkzeugen im Rahmen des operativen Ziels 1 der Initiative sowie zu den Pilotanlagen, die im Rahmen des operativen Ziels 2 der Initiative unterstützt werden;
 - b) Sensibilisierung und Bereitstellung von nötigem Know-how, Fachwissen und Fähigkeiten für die Interessenträger, damit sie die Entwicklung und Integration neuer Halbleitertechnik, Entwurfsoptionen und Systemkonzepte unter effektiver Nutzung der verfügbaren Ressourcen des Netzes beschleunigen können, und Schaffung von Anreizen für eine Erhöhung der Zahl der Studierenden und der Qualität der Ausbildung in den einschlägigen Studiengängen an europäischen Universitäten;
 - c) Sensibilisierung und Bereitstellung oder Zugangsgewährung zu Fachwissen, Know-how und Dienstleistungen, einschließlich Systementwurfsreife, neuen und bestehenden Pilotanlagen und Unterstützungsmaßnahmen, die für den Aufbau von Fähigkeiten und Kompetenzen erforderlich sind;
 - d) Erleichterung des Transfers von Fachwissen und Know-how zwischen Mitgliedstaaten und Regionen zur Förderung des Austauschs von Kompetenzen, Wissen und bewährten Verfahren sowie zur Förderung gemeinsamer Programme;

- e) Entwicklung und Verwaltung besonderer Schulungsmaßnahmen zur Halbleitertechnik und ihren Anwendungen, um die Entwicklung des Talentpools in der Union zu unterstützen.
- (3) Die Mitgliedstaaten benennen infrage kommende Kompetenzzentren nach ihren nationalen Verfahren und entsprechend ihren nationalen administrativen und institutionellen Strukturen in einem offenen und wettbewerblichen Verfahren. Im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens für Chips werden das Verfahren für die Einrichtung von Kompetenzzentren mit den Auswahlkriterien sowie weitere Aufgaben und Funktionen der Zentren bezüglich der Durchführung der Maßnahmen im Rahmen dieser Initiative, und das Verfahren zur Einrichtung des Netzes festgelegt. Das Gemeinsamen Unternehmen für Chips entscheidet über die Auswahl der Kompetenzzentren, die das Netz bilden sollen, und über die Einrichtung des Netzes. Die Mitgliedstaaten und die Kommission maximieren die Synergien mit bestehenden Kompetenzzentren, die wie die europäischen digitalen Innovationszentren im Rahmen anderer EU-Initiativen eingerichtet wurden.
- [(4) gestrichen]

[Artikel 9]

[in Artikel 5a aufgenommen]

KAPITEL III

VERSORGUNGSSICHERHEIT UND RESILIENZ

Artikel 10

Integrierte Produktionsstätten

- (1) Integrierte Produktionsstätten sind neuartige Fertigungsanlagen für Halbleiter in der Union, deren Produktionskapazitäten für eigene Zwecke genutzt werden und die zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen.
- (2) Eine integrierte Produktionsstätte gilt bei der Einreichung ihres Antrags gemäß Artikel 12 Absatz 1 als neuartige Anlage.
 - [a) gestrichen]
 - (2a) Eine integrierte Produktionsstätte muss folgende Anforderungen erfüllen:
 - b) ihre Einrichtung, ihr Betrieb oder ihre Produktion hat über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus positive Ausstrahlungseffekte auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union, was zu positiven Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems führt, die Zahl qualifizierter Arbeitskräfte ansteigen lässt und zum digitalen und grünen Wandel in der Union beiträgt;
 - c) sie gewährleistet, dass sie nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern in einer Weise unterworfen ist, die die Fähigkeit des Unternehmens, seine in Artikel 21 Absatz 1 genannten Verpflichtungen zu erfüllen, untergraben könnte, und sie verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;

- d) sie investiert in der Union in kontinuierliche Innovationen, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnik zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten.
- (3) Für die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovationen nach Absatz 2 Buchstabe d erhält die integrierte Produktionsstätte vorrangigen Zugang zu den gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b eingerichteten Pilotanlagen. Durch einen solchen vorrangigen Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen zu den Pilotanlagen weder ausgeschlossen noch verhindert.

Artikel 11

Offene EU-Fertigungsbetriebe

- (1) Offene EU-Fertigungsbetriebe sind neuartige Fertigungsanlagen für Halbleiter in der Union, die unabhängigen Unternehmen Produktionskapazitäten anbieten und somit zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen.
- (2) Ein offener EU-Fertigungsbetrieb gilt bei der Einreichung seines Antrags gemäß Artikel 12 Absatz 1 als neuartige Anlage.
- [a) gestrichen]
- (2a) Ein offener EU-Fertigungsbetrieb muss folgende Anforderungen erfüllen:
- b) seine Einrichtung, sein Betrieb oder seine Produktion hat über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus positive Ausstrahlungseffekte auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union, was zu positiven Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems führt, die Zahl qualifizierter Arbeitskräfte ansteigen lässt und zum digitalen und grünen Wandel in der Union beiträgt, wobei insbesondere berücksichtigt wird, inwieweit er von ihm unabhängigen Unternehmen Produktionskapazitäten anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht;

- c) er gewährleistet, dass er nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern in einer Weise unterworfen ist, die die Fähigkeit des Unternehmens, seine in Artikel 21 Absatz 1 genannten Verpflichtungen zu erfüllen, untergraben könnte, und er verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;
 - d) er investiert in der Union in kontinuierliche Innovationen, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnik zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten.
- (3) Bietet ein offener EU-Fertigungsbetrieb von ihm unabhängigen Unternehmen Produktionskapazitäten an, so muss er eine angemessene und wirksame funktionale Trennung der Entwurfs- und Fertigungsprozesse vornehmen und aufrechterhalten, um den Schutz der in jeder Phase gewonnenen Informationen zu gewährleisten.
- (4) Für die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovationen nach Absatz 2 Buchstabe d erhält der offene EU-Fertigungsbetrieb vorrangigen Zugang zu den gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b eingerichteten Pilotanlagen. Durch einen solchen vorrangigen Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen zu den Pilotanlagen weder ausgeschlossen noch verhindert.

Artikel 12

Statusverfahren

- (1) Jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium kann bei der Kommission einen Antrag darauf stellen, einem Projekt den Status als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb zu gewähren.
- (2) Die Kommission prüft unter Berücksichtigung der Standpunkte des Europäischen Halbleitergremiums den Antrag in einem fairen und transparenten Verfahren anhand folgender Elemente:

- a) Einhaltung der in Artikel 10 Absatz 2 bzw. Artikel 11 Absatz 2 festgelegten Kriterien und Verpflichtung zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 2a oder Artikel 11 Absatz 2a;
 - b) Geschäftsplan mit einer Bewertung der finanziellen Tragfähigkeit des Projekts unter Berücksichtigung seiner gesamten Lebensdauer und Informationen über geplante öffentliche Hilfen;
 - c) nachgewiesene Erfahrung des Antragstellers mit der Einrichtung und dem Betrieb ähnlicher Anlagen;
 - d) Vorlage eines geeigneten Nachweises für die Bereitschaft des/der Mitgliedstaat(en), in dem/denen der Antragsteller seine Anlage anzusiedeln gedenkt, die Einrichtung einer solchen Anlage zu unterstützen.
- (2a) Die Kommission beschließt über den Antrag. In diesem Beschluss wird die Dauer des Status auf der Grundlage der voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt. Die Kommission erlässt ihren Beschluss und setzt den Antragsteller innerhalb von sechs Monaten nach dem Eingang des vollständigen Antrags davon in Kenntnis. Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen Angaben unvollständig sind, so gibt sie dem Antragsteller Gelegenheit, die zur Vervollständigung des Antrags erforderlichen zusätzlichen Informationen unverzüglich einzureichen.
- (3) Die Kommission überwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der integrierten Produktionsstätten und der offenen EU-Fertigungsbetriebe und unterrichtet das Europäische Halbleitergremium regelmäßig hiervon.

Stellt die Kommission fest, dass eine Anlage die Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 2a bzw. Artikel 11 Absatz 2a nicht mehr erfüllt, gibt sie dem Betreiber der Anlage Gelegenheit, Stellung zu nehmen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.

- (3a) Der Betreiber der Anlage kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status zu überprüfen oder seine Durchführungspläne im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 2a bzw. Artikel 11 Absatz 2a zu ändern, wenn er dies aufgrund unvorhergesehener äußerer Umstände für hinreichend gerechtfertigt hält. Auf der Grundlage der Überprüfung kann die Kommission die Dauer des gemäß Absatz 2a gewährten Status ändern oder die Änderung der Durchführungspläne akzeptieren.
- (4) Stützte sich die Anerkennung auf einen Antrag mit unrichtigen Angaben oder erfüllt die Anlage trotz des Abschlusses des Verfahrens nach Absatz 3 die Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 2a bzw. Artikel 11 Absatz 2a nicht, so kann die Kommission den Beschluss über die Anerkennung des Status einer integrierten Produktionsstätte oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs aufheben. Bevor die Kommission einen solchen Beschluss fasst, konsultiert sie das Europäische Halbleitergremium, nachdem sie ihm die Gründe für eine solche Aufhebung mitgeteilt hat.
- (5) Anlagen, die keine integrierten Produktionsstätten oder offenen EU-Fertigungsbetriebe mehr sind, verlieren alle mit der Anerkennung dieses Status verbundenen Rechte, die sich aus dieser Verordnung ergeben. Anlagen, bei denen es sich nicht mehr um integrierte Produktionsstätten oder offene EU-Fertigungsbetriebe handelt, unterliegen jedoch während eines Zeitraums, der dem entspricht, der zum Zeitpunkt der Gewährung des Status gemäß Absatz 2a ursprünglich vorgesehen war, oder während der gemäß Absatz 3a geänderten Dauer, wenn der Status überprüft wurde, weiterhin der Verpflichtung gemäß Artikel 21 Absatz 1.

Artikel 13

Interesse der Union und öffentliche Unterstützung

- (1) Integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe, die zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen, werden als im Interesse der Union liegend betrachtet.

- (2) Um zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beizutragen, können die Mitgliedstaaten unbeschadet der Vorschriften der Artikel 107 und 108 AEUV zugunsten integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe Fördermaßnahmen anwenden und administrative Unterstützung gemäß Artikel 14 leisten.

Artikel 14

Beschleunigte Genehmigungsverfahren

- (1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verwaltungsanträge bezüglich der Planung, des Baus und des Betriebs integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe effizient und zügig bearbeitet werden. Dazu stellen alle betroffenen nationalen Behörden sicher, dass solche Anträge unter uneingeschränkter Achtung der Rechtsvorschriften und Verfahren der Mitgliedstaaten so schnell wie rechtlich möglich bearbeitet werden.
- (2) Die integrierten Produktionsstätten und offenen EU-Fertigungsbetriebe erhalten den national höchstmöglichen Status, wenn diese Unterscheidung vorgesehen ist, und werden in Genehmigungsverfahren entsprechend behandelt, auch in Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit und – sofern dies im nationalen Recht vorgesehen ist – in Raumordnungsverfahren.
- (3) Die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems können als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne des Artikels 6 Absatz 4 und des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 92/43/EWG und als Grund des übergeordneten öffentlichen Interesses im Sinne des Artikels 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG angesehen werden. Deshalb können Planung, Bau und Betrieb integrierter Produktionsstätten und offener EU-Fertigungsbetriebe als von überwiegendem öffentlichen Interesse betrachtet werden, sofern die in diesen Vorschriften festgelegten sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.

- (4) Für jede integrierte Produktionsstätte und jeden offenen EU-Fertigungsbetrieb kann jeder betreffende Mitgliedstaat eine Behörde benennen, die für die Erleichterung und Koordinierung von Verwaltungsanträgen in Bezug auf Planung, Bau und Betrieb zuständig ist. Jede benannte Behörde kann einen Koordinator ernennen, der als zentrale Anlaufstelle für die integrierte Produktionsstätte oder den offenen EU-Fertigungsbetrieb fungiert. Erfordert die Errichtung einer integrierten Produktionsstätte oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs Entscheidungen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten, so können die betreffenden benannten Behörden alle erforderlichen Maßnahmen für eine effiziente und wirksame Zusammenarbeit und Koordinierung untereinander ergreifen.

KAPITEL IV

ÜBERWACHUNG UND KRISENREAKTION

ABSCHNITT 1

ÜBERWACHUNG

Artikel 15

Überwachung

- (1) Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst die Überwachung der Halbleiter-Wertschöpfungskette folgende Tätigkeiten:
- a) Überwachung der gemäß Artikel 16 festgelegten Frühwarnindikatoren,
 - b) Überwachung der Integrität der Tätigkeiten der gemäß Artikel 17 festgelegten wichtigen Marktteilnehmer durch die Mitgliedstaaten.

Die Kommission legt nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums die Häufigkeit der Überwachung auf der Grundlage des Bedarfs in der Halbleiter-Wertschöpfungskette fest.

Die Kommission koordiniert die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung der Halbleiter-Wertschöpfungskette auf der Grundlage von Informationen, die durch Dienststellen der Kommission, die zuständigen nationalen Behörden oder andere Quellen wie internationale Partner erhoben wurden.

- (1a) Die Kommission sieht standardisierte und sichere Mittel für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a vor, wobei sie darauf achtet, den Verwaltungsaufwand für KMU so gering wie möglich zu halten.
- (1b) Für die Zwecke des Absatzes 1c erstellen und führen die zuständigen nationalen Behörden eine Kontaktliste, die alle in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen relevanten Unternehmen, die in der Halbleiter-Lieferkette tätig sind, enthält. Die Kommission legt ein standardisiertes Format für die Kontaktliste fest, um die Interoperabilität zu gewährleisten.
- (1c) Auf der Grundlage der in Absatz 1a vorgesehenen Mittel stellt die Kommission freiwillige Ersuchen im Hinblick auf die Durchführung von Überwachungstätigkeiten gemäß Absatz 1 Buchstabe a. Die Kommission sorgt für sichere Mittel für die Datenübermittlung.
- (1e) Auf der Grundlage der im Rahmen der Tätigkeiten gemäß Absatz 1 erhobenen Informationen legt die Kommission einen Bericht über die aggregierten Ergebnisse vor. Die Kommission übermittelt den Bericht dem Europäischen Halbleitergremium.
- (1f) Alle erhaltenen Auskünfte werden nach Maßgabe des Artikels 27 behandelt.

[(2) gestrichen]

[(3) gestrichen]

[(4) gestrichen]

[(5) gestrichen]

[(6) gestrichen]

[(7) gestrichen]

Artikel 16

Frühwarnindikatoren

1. Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Halbleitergremium eine Liste von Frühwarnindikatoren, um die Faktoren zu ermitteln, die die Versorgung und den Handel mit Halbleitern in der Union stören, beeinträchtigen oder nachteilig beeinflussen können. Diese Liste wird veröffentlicht.
- (1a) Die Überwachung der Frühwarnindikatoren erfolgt durch freiwillige Auskunftersuchen nach dem Verfahren des Artikels 15 Absätze 1a und 1c.
- (2) Die Kommission überprüft in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Halbleitergremium die Liste der Frühwarnindikatoren in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch alle zwei Jahre.
- [(3) gestrichen]

Artikel 17

Wichtige Marktakteure

- (1) Die Mitgliedstaaten ermitteln in Zusammenarbeit mit der Kommission in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene wichtige Marktakteure in den Halbleiter-Lieferketten und berücksichtigen dabei Folgendes:

- a) die Zahl anderer Unternehmen in der Union, von der von einem Marktakteur bereitgestellten Dienstleistung oder Ware abhängen;
 - b) den Marktanteil des wichtigen Marktakteurs auf dem Unions- oder Weltmarkt für solche Dienstleistungen oder Waren;
 - c) die Bedeutung eines Marktakteurs für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Angebots einer Dienstleistung oder Ware in der Union unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit alternativer Mittel für die Bereitstellung der Dienstleistung oder Ware;
 - d) die Auswirkungen einer Unterbrechung der Versorgung mit der von dem Marktakteur bereitgestellten Dienstleistung oder Ware auf die Halbleiter-Lieferkette und die davon abhängigen Märkte in der Union.
- (2) Die Mitgliedstaaten überwachen die Integrität der von den wichtigen Marktteilnehmern durchgeführten Tätigkeiten und berichten über größere Ereignisse, die die regelmäßige Ausführung dieser Tätigkeiten behindern könnten.

ABSCHNITT 2

WARNUNG UND KRISE

Artikel 17a

Warnung und Präventivmaßnahmen

- (1) Erlangt eine zuständige nationale Behörde Kenntnis von der Gefahr einer schweren Störung der Versorgung mit Halbleitern, so warnt sie unverzüglich die Kommission.
- (2) Nachdem die Kommission gemäß Absatz 1 gewarnt wurde oder wenn sie von der Gefahr einer schweren Störung der Versorgung mit Halbleitern, auch von internationalen Partnern, erfährt, führt sie die folgenden Präventivmaßnahmen durch:

- a) Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Europäischen Halbleitergremiums, um folgende Maßnahmen zu koordinieren:
1. Erörterung der Schwere der Störungen der Versorgung mit Halbleitern;
 2. Erörterung, ob es angemessen, notwendig und verhältnismäßig sein könnte, dass die Mitgliedstaaten als Präventivmaßnahme gemeinsam Halbleiter, Zwischenprodukte oder Rohstoffe beschaffen („koordinierte Beschaffung“);
 3. Aufnahme eines Dialogs mit Interessenträgern, um Präventivmaßnahmen zu ermitteln und vorzubereiten;
- b) im Namen der Union Aufnahme von Konsultationen oder einer Zusammenarbeit mit betreffenden Drittländern, um im Einklang mit internationalen Verpflichtungen kooperative Lösungen zur Bewältigung von Störungen der Lieferkette zu finden. Dies kann gegebenenfalls auch eine Koordinierung in einschlägigen internationalen Foren umfassen.
- (3) Die koordinierte Beschaffung, die nach der in Absatz 2 Buchstabe a Nummer 2 genannten Erörterung durchgeführt werden kann, wird von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den Vorschriften des Artikels 39 der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates²⁶ durchgeführt.

²⁶ Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

Artikel 18

Aktivierung der Krisenstufe

- (1) Erlangt die Kommission Kenntnis von der Gefahr einer schweren Störung der Versorgung mit Halbleitern gemäß Artikel 17a Absatz 2, so bewertet sie, ob die Voraussetzungen für die Aktivierung der Krisenstufe erfüllt sind. Ergibt diese Bewertung konkrete und zuverlässige Belege für schwere Störungen bei der Lieferung von Halbleitern oder schwerwiegende Hemmnisse für den Handel mit Halbleitern in der Union, die zu erheblichen Engpässen führen, die die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher Produkte, die in kritischen Sektoren verwendet werden, verhindern, so kann die Kommission nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums dem Rat vorschlagen, die Krisenstufe zu aktivieren.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Krisenstufe im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates aktivieren. Die Dauer der Krisenstufe ist begrenzt und wird im Durchführungsrechtsakt festgelegt. Die Kommission erstattet dem Europäischen Halbleitergremium in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch alle drei Monate, Bericht über den Stand der Krise.

[(2) gestrichen]

- (3) Vor Ablauf der Dauer, für die die Krisenstufe aktiviert wurde, prüft die Kommission nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums, ob die Krisenstufe verlängert werden sollte. Ist die Kommission der Auffassung, dass eine Verlängerung erforderlich ist, um der Halbleiterkrise in der Union in geeigneter Weise zu begegnen, so schlägt sie dem Rat vor, die Krisenstufe zu verlängern. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Krisenstufe im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates verlängern. Die Dauer der Verlängerung ist begrenzt und wird im Durchführungsrechtsakt des Rates festgelegt. Die Kommission kann vorschlagen, die Krisenstufe mehrmals zu verlängern, wenn dies hinreichend begründet ist.

- (3a) Während der Dauer der Krisenstufe bewertet die Kommission nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums die Angemessenheit einer vorzeitigen Beendigung der Krisenstufe. Ist die Kommission der Auffassung, dass eine vorzeitige Beendigung erforderlich ist, so schlägt sie dem Rat vor, die Krisenstufe zu beenden. Der Rat kann die Krisenstufe im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates beenden.
- (4) Während der Dauer der Krisenstufe beruft die Kommission erforderlichenfalls auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus außerordentliche Sitzungen des Europäischen Halbleitergremiums ein. Die Mitgliedstaaten arbeiten eng mit der Kommission zusammen und informieren zeitnah über alle nationalen Maßnahmen, die im Rahmen des Europäischen Halbleitergremiums in Bezug auf die Halbleiter-Lieferkette ergriffen werden.
- (5) Mit Ablauf der Zeitraums der Aktivierung der Krisenstufe oder im Falle ihrer vorzeitigen Beendigung gemäß Absatz 3a endet auch unmittelbar die Anwendung der nach den Artikeln 20, 21 und 22 ergriffenen Maßnahmen.

ABSCHNITT 3

REAKTION AUF ENGPÄSSE

Artikel 19

Notfallinstrumentarium

- (1) Wurde die Krisenstufe gemäß Artikel 18 Absatz 2 aktiviert und wenn dies zur Bewältigung der Halbleiterkrise in der Union erforderlich erscheint, kann die Kommission die in Artikel 20 vorgesehene Maßnahme unter den dort festgelegten Bedingungen treffen. Darüber hinaus kann die Kommission die in Artikel 21 und/oder Artikel 22 vorgesehenen Maßnahmen unter den dort festgelegten Bedingungen treffen.
- [(2) gestrichen]

- (3) Wurde die Krisenstufe gemäß Artikel 18 Absatz 2 aktiviert und wenn dies zur Bewältigung der Halbleiterkrise in der Union geeignet erscheint, kann das Europäische Halbleitergremium die erwarteten Auswirkungen einer möglichen Einführung von Schutzmaßnahmen bewerten und dabei die Frage prüfen, ob die Marktlage einem erheblichen Mangel an lebenswichtigen Gütern im Sinne der Verordnung (EU) 2015/479 entspricht, und hierzu eine Stellungnahme an die Kommission abgeben.
- (4) Die Anwendung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen muss verhältnismäßig sein, auf das Maß beschränkt werden, das zur Bewältigung schwerer Störungen mit Auswirkungen auf kritische Sektoren in der Union erforderlich ist und im besten Interesse der Union liegen. Bei der Anwendung dieser Maßnahmen wird vermieden, den KMU einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen.
- (5) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über alle nach Absatz 1 ergriffenen Maßnahmen und erläutert die Gründe für ihre Entscheidung.
- (6) Die Kommission kann nach Konsultation des Europäischen Halbleitergremiums Leitlinien für die Durchführung und Anwendung der Notmaßnahmen herausgeben.

Artikel 20

Einholung von Informationen

- (1) Wird die Krisenstufe gemäß Artikel 18 Absatz 2 aktiviert, so kann die Kommission in der Halbleiter-Lieferkette tätige Unternehmen auffordern, Auskünfte über ihre Produktionskapazitäten, Produktionskapazitäten und aktuellen Primärunterbrechungen bereitzustellen. Die verlangten Auskünfte werden auf das erforderliche Maß beschränkt, um die Art der Halbleiterkrise zu beurteilen oder mögliche Gegenmaßnahmen oder Notmaßnahmen zu ermitteln und zu prüfen, die auf nationaler Ebene oder auf Unionsebene getroffen werden können. Die Anforderungen von Auskünften dürfen nicht zur Erteilung von Auskünften führen, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen würde.

- (1a) Bevor die Kommission Auskünfte anfordert, führt sie eine freiwillige Konsultation einer repräsentativen Anzahl relevanter Unternehmen durch, um den angemessenen und verhältnismäßigen Inhalt einer solchen Anforderung zu ermitteln. Die Kommission erarbeitet die Anforderung von Auskünften in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Halbleitergremium.
- (1b) Die Kommission verwendet die in Artikel 15 Absatz 1a genannten sicheren Mittel, um Auskünfte anzufordern. Zu diesem Zweck übermitteln die zuständigen nationalen Behörden der Kommission die gemäß Artikel 15 Absatz 1b erstellte Kontaktliste. Alle erhaltenen Informationen werden nach Maßgabe des Artikels 27 behandelt. Die Kommission leitet eine Kopie der Anforderung von Auskünften unverzüglich an die zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats weiter, in dessen Hoheitsgebiet sich die Produktionsstätte des betreffenden Unternehmens befindet. Auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörde übermittelt die Kommission die von dem betreffenden Unternehmen erlangten Auskünfte im Einklang mit dem Unionsrecht.
- (2) Die Anforderung von Auskünften enthält deren Rechtsgrundlage, ist im Hinblick auf die Granularität und den Umfang der Daten sowie die Häufigkeit des Zugangs zu den angeforderten Daten verhältnismäßig, berücksichtigt die rechtmäßigen Ziele des Unternehmens sowie die Kosten und den Aufwand, die für die Bereitstellung der Daten erforderlich sind, und enthält die gesetzte Frist, in der die Informationen zu übermitteln sind. Sie enthält einen Hinweis auf die in Artikel 28 vorgesehenen Sanktionen.
- (3) Die Inhaber der Unternehmen oder deren Vertreter oder – im Fall von juristischen Personen, Gesellschaften und Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit – die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen erteilen die verlangten Auskünfte im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, wenn die erteilten Auskünfte unvollständig, sachlich unrichtig und irreführend sind.

- (4) Gegen ein Unternehmen, dass auf eine Anforderung nach diesem Artikel vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige, unvollständige oder irreführende Auskünfte erteilt oder innerhalb der gesetzten Frist keine Auskünfte erteilt, werden Geldbußen nach Artikel 28 verhängt, es sei denn, das Unternehmen erteilt nicht die verlangten Auskünfte aus hinreichend gerechtfertigten Gründen.
- (5) Sollte ein in der Union niedergelassenes Unternehmen von einem Drittland um Informationen im Zusammenhang mit seinen Halbleitertätigkeiten ersucht werden, so unterrichtet es die Kommission in einer Weise, die es ihr ermöglicht, ähnliche Informationen anzufordern. Die Kommission informiert das Europäische Halbleitergremium über ein solches Ersuchen eines Drittlands.

Artikel 21

Vorrangige Aufträge

- (1) Wird die Krisenstufe gemäß Artikel 18 Absatz 2 aktiviert, kann die Kommission integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe dazu verpflichten, Aufträge für krisenrelevante Produkte, die entweder direkt in kritischen Sektoren eingesetzt werden oder zur Herstellung von in kritischen Sektoren genutzten Geräten verwendet werden, anzunehmen und vorrangig zu behandeln („vorrangige Aufträge“). Diese Verpflichtung geht jeder anderen Erfüllungsverpflichtung nach privatem oder öffentlichem Recht vor.
- (2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 kann auch anderen Halbleiterunternehmen in Bezug auf ihre Fertigungsanlagen für Halbleiter auferlegt werden, für die sie diese Möglichkeit im Rahmen des Erhalts öffentlicher Unterstützung akzeptiert haben.
- (3) Wenn ein in der Union niedergelassenes Halbleiterunternehmen einer Pflicht zur Erfüllung vorrangiger Aufträge gegenüber einem Drittland unterliegt, so teilt es dies der Kommission mit. Sollte sich diese Verpflichtung erheblich auf das Funktionieren bestimmter kritischer Sektoren auswirken, kann die Kommission das Unternehmen dazu verpflichten, Aufträge für krisenrelevante Produkte im Einklang mit den Absätzen 4, 5 und 6 anzunehmen und vorrangig zu behandeln.

- (3a) Vorrangige Aufträge sind Begünstigten vorbehalten, deren Tätigkeiten gestört oder von Störungen bedroht sind und die nicht in der Lage waren, die Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel zu vermeiden und abzufedern. Die Kommission kann einen Begünstigten auffordern, entsprechende Nachweise vorzulegen.
- (4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 werden von der Kommission durch einen Beschluss auferlegt. Vor dem Erlass der Einzelbeschlüsse konsultiert die Kommission das Europäische Halbleitergremium zur Verwendung vorrangiger Aufträge für den betreffenden kritischen Sektor. Der Beschluss wird im Einklang mit allen in der Union für die Umstände des Falls geltenden rechtlichen Verpflichtungen, einschließlich der Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit, erlassen. Der Beschluss trägt insbesondere den rechtmäßigen Zielen des betreffenden Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand jeder Änderung der Produktionsreihenfolge Rechnung. In ihrem Beschluss nennt die Kommission die Rechtsgrundlage des vorrangigen Auftrags, setzt die Frist für die Erfüllung des Auftrags, gibt gegebenenfalls das Produkt und die Menge an und weist auf die in Artikel 28 für die Nichteinhaltung der Verpflichtung vorgesehenen Sanktionen hin. Der vorrangige Auftrag wird zu fairen und angemessenen Preis vergeben.
- (5) Vor der Erteilung vorrangiger Aufträge gemäß Absatz 1 gibt die Kommission dem vorgesehenen Empfänger eines vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur Durchführbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu äußern. Die Kommission erteilt den vorrangig bewerteten Auftrag nicht, wenn
- a) das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermögens oder unzureichender Produktionskapazität nicht in der Lage ist, den vorrangigen Auftrag auszuführen, selbst wenn es diesen Auftrag vorrangig behandelt;
 - b) die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Härte für das Unternehmen darstellen würde.

- (6) Ist ein Unternehmen verpflichtet, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und vorrangig zu behandeln, so haftet es nicht für Verstöße gegen vertragliche Pflichten, die erforderlich sind, um die vorrangigen Aufträge zu erfüllen. Die Haftungsbefreiung gilt nur insoweit, wie der Verstoß gegen vertragliche Pflichten für die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war.
- (7) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der praktischen und operativen Modalitäten für die Funktionsweise der vorrangigen Aufträge. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 22

Gemeinsame Beschaffung

- (1) Wird die Krisenstufe gemäß Artikel 18 Absatz 2 aktiviert, so kann die Kommission auf Antrag von zwei oder mehr Mitgliedstaaten die Rolle einer zentralen Beschaffungsstelle im Namen aller zur Beteiligung bereiten Mitgliedstaaten (im Folgenden „beteiligte Mitgliedstaaten“) bei der Vergabe öffentlicher Aufträge für krisenrelevante Produkte, die entweder direkt in kritischen Sektoren eingesetzt oder zur Herstellung von in kritischen Sektoren genutzten Geräten verwendet werden, zu übernehmen („gemeinsame Beschaffung“). Die Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung lässt andere Beschaffungsverfahren unberührt.
- (2) Die Kommission prüft unter Berücksichtigung der Standpunkte des Europäischen Halbleitergremiums den Nutzen, die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit des Antrags. Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht nachzukommen, so teilt sie dies den betroffenen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Halbleitergremium mit und nennt die Gründe für ihre Ablehnung.
- (3) Die Kommission arbeitet einen Vorschlag für eine Vereinbarung aus, die von den beteiligten Mitgliedstaaten zu unterzeichnen ist. In dieser Vereinbarung sind die Einzelheiten der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Beschaffung geregelt und ist das Mandat für die Kommission festgelegt, im Namen der beteiligten Mitgliedstaaten zu handeln.

- (4) Die Beschaffung im Rahmen dieser Verordnung wird von der Kommission im Einklang mit den für ihre eigenen Beschaffungsverfahren geltenden Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates²⁷ (Haushaltsordnung) durchgeführt. Die Kommission kann die Befugnis und Verantwortung wahrnehmen, im Namen aller beteiligten Mitgliedstaaten Verträge mit Wirtschaftsteilnehmern, auch einzelnen Herstellern krisenrelevanter Produkte, über den Erwerb solcher Produkte oder über die Finanzierung der Herstellung oder Entwicklung solcher Produkte im Gegenzug für ein vorrangiges Zugriffsrecht auf die Ergebnisse zu schließen.
- (5) Falls die Beschaffung krisenrelevanter Produkte eine Finanzierung aus dem Unionshaushalt umfasst, können besondere Bedingungen in besonderen Vereinbarungen mit Wirtschaftsteilnehmern festgelegt werden.
- (6) Die Kommission führt die Beschaffungsverfahren durch und schließt die daraus resultierenden Verträge mit den Wirtschaftsteilnehmern im Namen der beteiligten Mitgliedstaaten. Die Kommission fordert die beteiligten Mitgliedstaaten auf, Vertreter zu benennen, die an der Vorbereitung der Beschaffungsverfahren teilnehmen. Für die Einführung und den Weiterverkauf der beschafften Produkte bleiben die beteiligten Mitgliedstaaten verantwortlich.
- (7) Die Einführung der gemeinsamen Beschaffung gemäß diesem Artikel lässt andere in der Haushaltsordnung vorgesehene Instrumente unberührt.

²⁷ Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

KAPITEL V

LEITUNGSSTRUKTUR

ABSCHNITT 1

EUROPÄISCHES HALBLEITERGREMIIUM

Artikel 23

Einrichtung und Aufgaben des Europäischen Halbleitergremiums

- (1) Das Europäische Halbleitergremium (European Semiconductor Board) wird eingerichtet.
- (2) Das Europäische Halbleitergremium berät und unterstützt die Kommission und gibt ihr Empfehlungen nach Maßgabe dieser Verordnung, insbesondere durch
 - a) Beratung des Rates der öffentlichen Körperschaften des Gemeinsamen Unternehmens für Chips in Bezug auf die Initiative;
 - b) Beratung der Kommission bei der Bewertung der Anträge für integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe;
 - c) Erörterung und Vorbereitung der Festlegung bestimmter Sektoren und Technologien mit potenziell hoher sozialer oder ökologischer Wirkung, für die daher eine Zertifizierung als grüne, vertrauenswürdige und sichere Produkte nötig ist;
 - d) Befassung mit Fragen der Überwachung und Krisenreaktion;

- e) Beratung und Abgabe von Empfehlungen bezüglich der Umsetzung dieser Verordnung, der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und des Informationsaustauschs über Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung.
- (3) Das Europäische Halbleitergremium unterstützt die Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit, einschließlich der Einholung von Informationen und der Krisenbewertung, im Einklang mit internationalen Verpflichtungen.
- (4) Der Europäische Halbleitergremium gewährleistet gegebenenfalls die Koordinierung, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den einschlägigen Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen, die nach Unionsrecht geschaffen wurden.
- (5) Das Europäische Halbleitergremium kann sich in angemessenem Umfang mit interessierten Dritten austauschen, um Informationen für seine Tätigkeiten zu erhalten.

Artikel 24

Struktur des Europäischen Halbleitergremiums

- (1) Der Europäische Halbleitergremium setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen; den Vorsitz führt ein Vertreter der Kommission.
- (2) jeder Mitgliedstaat ernennt einen hochrangigen Vertreter im Europäischen Halbleitergremium. Soweit dies im Hinblick auf die Funktion und das Fachwissen zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat mehr als einen Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben des Europäischen Halbleitergremium haben. Jedes Mitglied des Europäischen Halbleitergremiums hat einen Stellvertreter. Das Europäische Halbleitergremium entscheidet nach Möglichkeit einvernehmlich. Wenn kein Einvernehmen erzielt werden kann, entscheidet das Europäischen Halbleitergremium mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten. Jeder Mitgliedstaat hat unabhängig von der Zahl seiner Vertreter nur eine Stimme.

- (3) Das Europäische Halbleitergremium gibt sich in seiner ersten Sitzung auf Vorschlag und mit Zustimmung der Kommission eine Geschäftsordnung.
- (4) Die Kommission kann ständige oder nichtständige Untergruppen zur Prüfung spezifischer Fragen einsetzen. Die Kommission kann gegebenenfalls Organisationen, die die Interessen der Halbleiter-Wertschöpfungskette vertreten, einschließlich der Industriallianz für Prozessoren und Halbleitertechnik und Abnehmer von Halbleitern auf Unionsebene, als Beobachter zu solchen Untergruppen einladen. Es wird eine Untergruppe eingesetzt, der Forschungs- und Technologieorganisationen der Union angehören, um besondere Aspekte der strategischen technologischen Ausrichtung zu prüfen und dem Europäischen Halbleitergremium hierüber Bericht zu erstatten.

Artikel 25

Arbeitsweise des Europäischen Halbleitergremiums

- (1) Das Europäische Halbleitergremium hält mindestens einmal jährlich eine ordentliche Sitzung ab. Es kann auf Verlangen der Kommission oder eines Mitgliedstaats außerordentliche Sitzungen gemäß Artikel 15 und Artikel 18 abhalten.
- (2) Das Europäische Halbleitergremium hält für seine in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a genannten Aufgaben und für seine in Artikel 23 Absatz 2 Buchstaben b, c und d genannten Aufgaben jeweils getrennte Sitzungen ab.
- (3) Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Einklang mit den Aufgaben des Europäischen Halbleitergremiums gemäß dieser Verordnung und seiner Geschäftsordnung vor. Die Kommission leistet gemäß Artikel 23 administrative und analytische Unterstützung für die Tätigkeiten des Europäischen Halbleitergremiums.

- (4) Der Vorsitz kann Sachverständige mit besonderem Fachwissen zum betreffenden Sachgebiet, auch von Organisationen der Interessenträger, einladen und Beobachter, auch auf Vorschlag von Mitgliedern, benennen, die an den Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitz kann den Austausch zwischen dem Europäischen Halbleitergremium und anderen Einrichtungen, Ämtern, Agenturen, Sachverständigen und Beratungsgruppen der Union fördern. Zu diesem Zweck lädt der Vorsitz einen Vertreter des Europäischen Parlaments als Beobachter in das Europäische Halbleitergremium ein. Der Vorsitz gewährleistet die Teilnahme anderer einschlägiger Organe, Einrichtungen und Stellen der Union als Beobachter im Europäischen Halbleitergremium im Hinblick auf Sitzungen in Bezug auf Kapitel IV zur Überwachung und Krisenreaktion.
- (4a) Beobachter und Sachverständige haben kein Stimmrecht und nehmen nicht an der Ausarbeitung von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Ratschlägen des Europäischen Halbleitergremiums und seiner Untergruppen teil.
- (5) Das Europäische Halbleitergremium trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die sichere Behandlung und Verarbeitung vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

ABSCHNITT 2

ZUSTÄNDIGE NATIONALE BEHÖRDEN

Artikel 26

Benennung zuständiger nationaler Behörden und zentraler Anlaufstellen

- (1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zuständige nationale Behörden, die auf nationaler Ebene die Anwendung und Umsetzung dieser Verordnung sicherstellen.

- (2) Benennen die Mitgliedstaaten mehr als eine zuständige nationale Behörde, so legen sie die jeweiligen Zuständigkeiten der betreffenden Behörden eindeutig fest und sorgen dafür, dass diese Behörden wirksam und effizient zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung zu erfüllen, auch bezüglich der Benennung und der Tätigkeiten der in Absatz 3 genannten nationalen zentralen Anlaufstelle.
- (3) Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale zentrale Anlaufstelle, die als Verbindungsstelle zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden anderer Mitgliedstaaten, mit der Kommission und mit dem Europäischen Halbleitergremium fungiert (im Folgenden „zentrale Anlaufstelle“). Benennt ein Mitgliedstaat nur eine zuständige Behörde, so ist diese zuständige Behörde auch die zentrale Anlaufstelle.
- (4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Benennung der zuständigen nationalen Behörde oder von mehr als einer zuständigen nationalen Behörde, die Benennung der nationalen zentralen Anlaufstelle mit deren genauen Aufgaben und Zuständigkeiten gemäß dieser Verordnung sowie deren Kontaktangaben und etwaige spätere Änderungen mit.
- (5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen nationalen Behörden und die benannten zentralen Anlaufstellen ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und rechtzeitig ausüben und dass ihnen die nötigen Befugnisse und angemessene technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellt werden.
- (6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen nationalen Behörden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht gegebenenfalls andere einschlägige nationale Behörden und betreffende interessierte Kreise konsultieren und mit ihnen zusammenarbeiten. Die Kommission fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den zuständigen nationalen Behörden.

KAPITEL VI

VERTRAULICHKEIT UND SANKTIONEN

Artikel 27

Behandlung vertraulicher Informationen

- (-2) Die im Zuge der Durchführung dieser Verordnung erlangten Informationen dürfen nur für die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und werden durch die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten geschützt.
- (-1) Informationen, die gemäß den Artikeln 12, 15 und 20 sowie Artikel 21 Absatz 3 erlangt werden, fallen unter das Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der Union geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist.
- (1) Die Kommission und die nationalen Behörden, ihre Beamten, Bediensteten und sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behörden tätig sind, gewährleisten die Vertraulichkeit der Informationen, von denen sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten Kenntnis erhalten. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter der Mitgliedstaaten, Beobachter, Sachverständige und sonstige Personen, die an den Sitzungen des Europäischen Halbleitergremiums gemäß Artikel 23 teilnehmen, sowie für die Mitglieder des Ausschusses gemäß Artikel 33 Absatz 1.

- (2) Sofern erforderlich, können die Kommission und die Mitgliedstaaten mit den zuständigen Behörden von Drittländern, mit denen sie bilaterale oder multilaterale Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben, um ein angemessenes Niveau an Vertraulichkeit zu gewährleisten, die gemäß den Artikeln 15 und 20 erlangten Informationen nur in aggregierter Form austauschen, damit verhindert wird, dass Rückschlüsse auf die spezifische Situation eines Unternehmens in einem Mitgliedstaat gezogen werden können. Bevor die Kommission oder die Mitgliedstaaten den Informationsaustausch aufnehmen, teilen sie dem Europäischen Halbleitergremium die Informationen, die weitergegeben werden sollen, und die entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung mit.
- (3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um die praktischen Modalitäten der Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen des Informationsaustauschs gemäß dieser Verordnung festzulegen, sofern dies aufgrund der Erfahrungen bei der Einholung von Informationen erforderlich ist. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 28

Sanktionen und Geldbußen

- (1) Hält es die Kommission für erforderlich und verhältnismäßig, so kann sie – nachdem sie gemäß Artikel 31 Gelegenheit zur Anhörung gegeben hat – durch Beschluss
- a) Geldbußen verhängen, wenn ein Unternehmen auf eine Anforderung gemäß Artikel 20 vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige, unvollständige oder irreführende Auskünfte erteilen oder diese Auskünfte nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erteilt;
 - b) Geldbußen verhängen, wenn ein Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig der Verpflichtung zur Unterrichtung der Kommission über eine Drittlandsverpflichtung gemäß Artikel 20 Absatz 5 und Artikel 21 Absatz 3 nicht nachkommt, es sei denn, das Unternehmen erteilt nicht die verlangten Auskünfte aus hinreichend gerechtfertigten Gründen;

- c) Zwangsgelder verhängen, wenn ein Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter Produkte gemäß Artikel 21 nicht nachkommt.

Die Kommission unterrichtet das Europäische Halbleitergremium über alle gemäß diesem Absatz gefassten Beschlüsse.

- (2) Die in Fällen gemäß Absatz 1 Buchstabe a verhängten Geldbußen dürfen 300 000 EUR nicht übersteigen. Die in Fällen gemäß Absatz 1 Buchstaben b verhängten Geldbußen dürfen 150 000 EUR nicht übersteigen. Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, dürfen die verhängten Geldbußen 50 000 EUR nicht übersteigen.
- (3) Die in Fällen gemäß Absatz 1 Buchstabe c verhängten Zwangsgelder dürfen 1,5 % des aktuellen Tagesumsatzes für jeden Arbeitstag, an dem der Verstoß gegen die gemäß Artikel 21 auferlegte Verpflichtung anhält, gerechnet ab dem im Beschluss zur Erteilung des vorrangigen Auftrags festgelegten Tag, nicht übersteigen. Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, dürfen die verhängten Zwangsgelder 0,5 % des aktuellen Tagesumsatzes nicht übersteigen.
- (4) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße oder des Zwangsgelds ist der Art, der Schwere und der Dauer des Verstoßes – einschließlich im Falle der Nichterfüllung des vorrangigen Auftrags gemäß Artikel 21, auch wenn das Unternehmen den vorrangigen Auftrag teilweise erfüllt hat – sowie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit Rechnung zu tragen.
- (5) Ist das Unternehmen der Verpflichtung, zu deren Erfüllung das Zwangsgeld verhängt worden war, nachgekommen, so kann die Kommission als endgültige Höhe des Zwangsgelds einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus dem ursprünglichen Beschluss ergeben würde.

- (6) Der Gerichtshof der Europäischen Union besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von Beschlüssen der Kommission zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Er kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.

Artikel 29

Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern

- (1) Die Befugnis der Kommission nach Artikel 28 verjährt
- a) zwei Jahre bei Verstößen gegen Bestimmungen über Auskunftersuchen gemäß Artikel 20;
 - b) zwei Jahre bei Verstößen gegen Bestimmungen über die Verpflichtung zur Unterrichtung gemäß Artikel 20 Absatz 5 und Artikel 21 Absatz 3;
 - c) drei Jahre bei Verstößen gegen Bestimmungen über die Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter Produkte gemäß Artikel 21.
- (2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Verstoß begangen wurde. Bei anhaltenden oder wiederholten Verstößen läuft die Verjährungsfrist hingegen ab dem Tag, an dem der letzte Verstoß begangen wurde.
- (3) Jede Maßnahme der Kommission oder der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die dazu dient, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung sicherzustellen, unterbricht die Verjährungsfrist.
- (4) Die Unterbrechung der Verjährungsfrist gilt für alle Parteien, die sich für eine Beteiligung an dem Verstoß verantworten müssen.

- (5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens an dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die Verjährungsfrist gehemmt ist, weil gegen den Beschluss der Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängig ist.

Artikel 30

Verjährungsfrist für die Vollstreckung von Sanktionen

- (1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von Beschlüssen nach Artikel 28 verjährt nach Ablauf von fünf Jahren.
- (2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskräftig wird.
- (3) Die Verjährungsfrist für die Vollstreckung von Geldbußen und Zwangsgeldern wird unterbrochen durch
- a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des Zwangsgelds geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird,
 - b) jede auf Vollstreckung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Handlung der Kommission oder eines Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt.

- (4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.
- (5) Die Verjährungsfrist für die Vollstreckung von Geldbußen und Zwangsgeldern ruht, solange
 - a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist;
 - b) die Vollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

Artikel 31

Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern

- (1) Bevor die Kommission einen Beschluss nach Artikel 28 erlässt, gibt sie dem betreffenden Unternehmen Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern:
 - a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der Beschwerdepunkte;
 - b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen Beurteilung nach Buchstabe a dieses Absatzes zu treffen beabsichtigt.
- (2) Das betreffende Unternehmen kann sich innerhalb einer von der Kommission in der vorläufigen Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a gesetzten Frist, die mindestens 14 Tage betragen muss, zu der vorläufigen Beurteilung der Kommission äußern.
- (3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse nur auf Beschwerdepunkte, zu denen sich das betreffende Unternehmen äußern konnte.

- (4) Die Verteidigungsrechte des betreffenden Unternehmens werden während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Das Unternehmen hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akte der Kommission im Rahmen einer einvernehmlichen Einsichtnahme. Von der Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Schriftstücke der Kommission und der Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die Korrespondenz zwischen der Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten ist von der Akteneinsicht ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und Verwendung der für den Nachweis eines Verstoßes erforderlichen Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

KAPITEL VII

AUSSCHUSSVERFAHREN

[Artikel 32]

[gestrichen]

Artikel 33

Ausschuss

- (1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden „Halbleiterausschuss“) unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
- (2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
- (3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240

(1) Die Verordnung (EU) 2021/694 wird wie folgt geändert:

1. In **Artikel 3 Absatz 2** wird folgender Buchstabe f angefügt:

„f) spezifisches Ziel 6 – Halbleiter“.

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt:

„Artikel 8a

Spezifisches Ziel 6 – Halbleiter

Mit dem finanziellen Beitrag der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 6 – Halbleiter werden die Ziele verfolgt, die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung XX/XX des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt sind.“

3. **Artikel 9 Absätze 1 und 2** werden wie folgt geändert:

„Artikel 9

Mittelausstattung

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 auf 8 238 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt.

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag wird indikativ wie folgt aufgeteilt:

2 076 914 000 EUR für das spezifische Ziel 1 – Hochleistungsrechnen;

1 841 956 000 EUR für das spezifische Ziel 2 – Künstliche Intelligenz;

1 529 566 000 EUR für das spezifische Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen;

517 347 000 EUR für das spezifische Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale Kompetenzen;

1 022 217 000 EUR für das spezifische Ziel 5 – Einführung und optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und Interoperabilität;

1 250 000 000 EUR für das spezifische Ziel 6 – Halbleiter.“

4. **Artikel 11 Absatz 2** erhält folgende Fassung:

„(2) Die Zusammenarbeit mit in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Drittländern und Organisationen im Rahmen der spezifischen Ziele 1, 2, 3 und 6 unterliegt Artikel 12.“

5. **Artikel 12** Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Aus hinreichend gerechtfertigten Sicherheitsgründen kann im Arbeitsprogramm auch vorgesehen werden, dass sich Rechtsträger mit Sitz in assoziierten Ländern und Rechtsträger mit Sitz in der Union, die aber aus Drittländern kontrolliert werden, an einigen oder allen Maßnahmen im Rahmen der spezifischen Ziele 1, 2 **und 6** nur dann beteiligen dürfen, wenn sie den von diesen Rechtsträgern zu erfüllenden Anforderungen genügen, damit der Schutz der grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union und der Mitgliedstaaten gewährleistet und für den Schutz von Informationen in Verschlusssachen gesorgt ist. Die entsprechenden Anforderungen sind im Arbeitsprogramm enthalten.“

6. In **Artikel 13** wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Synergien zwischen dem spezifischen Ziel 6 und anderen Unionsprogrammen werden in Artikel 6 und in Anhang III der Verordnung XX/XX beschrieben.“

7. **Artikel 14** wird wie folgt geändert:

Absatz 1 erhält folgende Fassung:

8. „(1) Das Programm wird gemäß den Artikeln 4 bis 8a der vorliegenden Verordnung in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder in indirekter Mittelverwaltung, indem die in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung genannten Einrichtungen mit bestimmten Durchführungsaufgaben betraut werden, durchgeführt. Einrichtungen, die mit der Durchführung des Programms betraut sind, dürfen von den in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften für die Teilnahme und die Verbreitung nur dann abweichen, wenn diese Abweichung im Rechtsakt zur Errichtung dieser Einrichtungen oder zur Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an sie vorgesehen ist oder – im Fall von Einrichtungen nach Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c Ziffer ii, iii oder v der Haushaltsordnung – wenn eine solche Abweichung in der Beitragsvereinbarung vorgesehen sowie aufgrund besonderer betrieblicher Erfordernisse dieser Einrichtungen oder der Art der Maßnahme notwendig ist.“
9. In **Artikel 14** wird folgender Absatz angefügt:
- „(4) Sind die Bedingungen des Artikels 22 der Verordnung XX/XX erfüllt, so finden die Bestimmungen des genannten Artikels Anwendung.“
10. **Artikel 17** Absatz 1 erhält folgende Fassung:
- „(1) Nur Maßnahmen, die zur Erreichung der in den Artikeln 3 bis 8a genannten Ziele beitragen, sind förderfähig.“
11. In **Anhang I** wird folgender Absatz angefügt:
- „Spezifisches Ziel 6 – Halbleiter
- Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 6 werden in Artikel 5 der Verordnung XX/XX aufgeführt.“

12. In **Anhang II** wird folgender Absatz angefügt:

„Spezifisches Ziel 6 – Halbleiter

Messbare Indikatoren für die Überwachung der Durchführung und für die Berichterstattung über die Fortschritte des Programms in Bezug auf das spezifische Ziel 6 werden in Anhang II der Verordnung XX/XX aufgeführt.“

13. In **Anhang III** wird der folgende Absatz angefügt:

„Spezifisches Ziel 6 – Halbleiter

Synergien mit Unionsprogrammen für das spezifische Ziel 6 werden in Anhang III der Verordnung XX/XX aufgeführt.“

Artikel 35

Bewertung und Überprüfung

- (1) Drei Jahre nach dem Datum der Anwendung dieser Verordnung und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der Bericht wird veröffentlicht.
- (2) Für die Zwecke der Bewertung und Überprüfung übermitteln das Europäische Halbleitergremium, die Mitgliedstaaten und die zuständigen nationalen Behörden der Kommission auf Anfrage die gewünschten Informationen.

- (3) Bei der Durchführung der Bewertung und Überprüfung berücksichtigt die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Halbleitergremiums, des Europäischen Parlaments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen.

Artikel 36

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident / Die Präsidentin

Der Präsident / Die Präsidentin

[Anhang I der ANLAGE]

[gestrichen]

MESSBARE INDIKATOREN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DER DURCHFÜHRUNG
UND FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE FORTSCHRITTE BEI DER
ERREICHUNG DER ZIELE DER INITIATIVE

1. Anzahl der Rechtsträger (unterteilt nach Größe, Art und Niederlassungsland), die an den durch die Initiative unterstützten Maßnahmen beteiligt sind.

In Bezug auf das operative Ziel 1:

2. Anzahl der im Rahmen der Initiative entwickelten oder integrierten Entwurfswerkzeuge.

In Bezug auf das operative Ziel 2:

3. Gesamtbetrag der Koinvestitionen des Privatsektors in Entwurfskapazitäten und Pilotanlagen im Rahmen der Initiative.

In Bezug auf das operative Ziel 3:

4. Anzahl der Nutzer oder Nutzergemeinschaften, die im Rahmen der Initiative Zugang zu Entwurfskapazitäten und Pilotanlagen anstreben.

In Bezug auf das operative Ziel 4:

5. Anzahl der Unternehmen, die die Dienste der durch die Initiative unterstützten nationalen Kompetenzzentren in Anspruch genommen haben.
6. Anzahl der Personen, die Ausbildungsprogramme zum Erwerb fortgeschrittener Kompetenzen, die im Rahmen der Initiative gefördert wurden, und Schulungen im Bereich Halbleiter- und Quantentechnologien erfolgreich abgeschlossen haben.
- 6a. Anzahl der aktiven Kompetenzzentren in der EU, die Teil des europäischen Netzes von Kompetenzzentren im Rahmen der Initiative sind.

In Bezug auf das operative Ziel 5:

7. Anzahl der Start-ups, Scale-ups und KMU, die Wagniskapital aus den „Chip-Fonds“-Maßnahmen erhalten haben und Gesamtbetrag der getätigten Kapitalinvestitionen.
 8. Anzahl der in der EU tätigen Unternehmen, einschließlich ihres Tätigkeitssegments in der Wertschöpfungskette.
-

SYNERGIEN MIT ANDEREN PROGRAMMEN DER UNION

1. Synergien zwischen der Initiative und den spezifischen Zielen 1 bis 5 des **Programms „Digitales Europa“** sollen Folgendes sicherstellen:
 - a) Der angestrebte thematische Schwerpunkt der Initiative für Halbleiter- und Quantentechnik ist komplementär.
 - b) Die spezifischen Ziele 1 bis 5 des Programms „Digitales Europa“ unterstützen den Aufbau digitaler Kapazitäten im Bereich der fortgeschrittenen digitalen Technologien, einschließlich *Hochleistungsrechnen, künstlicher Intelligenz* und *Cybersicherheit*; und fördern auch fortgeschrittene digitale Kompetenzen.
 - c) Die Initiative wird in den Kapazitätsaufbau investieren, um fortschrittliche Entwurfs-, Fertigungs- und Systemintegrationsfähigkeiten in hochmoderner *Halbleiter- und Quantentechnik* der nächsten Generation für die innovative Unternehmensentwicklung zu stärken, die Halbleiterliefer- und -wertschöpfungsketten in Europa zu festigen, Schlüsselindustrien zu unterstützen und neue Märkte zu schaffen.

2. Synergien mit **Horizont Europa** müssen Folgendes sicherstellen:
 - a) Auch wenn sich bestimmte thematische Bereiche der Initiative und von Horizont Europa überschneiden, unterscheiden und ergänzen sich die Art der zu unterstützenden Maßnahmen, die jeweils erwarteten Ergebnisse sowie die jeweilige Interventionslogik.
 - b) Horizont Europa fördert die Forschung, die technologische Entwicklung, Demonstrationsprojekte, Pilotprojekte, Konzeptnachweise, Tests und Prototypentwicklung, einschließlich der vorkommerziellen Einführung innovativer digitaler Technologien, insbesondere durch

- i) ein eigenes Budget für den Cluster „Digitalisierung, Industrie und Weltraum“ im Rahmen der Säule „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ zur Entwicklung grundlegender Technologien (KI und Robotik, Internet der nächsten Generation, Hochleistungsrechnen und Big Data, digitale Schlüsseltechnologien (einschließlich Mikroelektronik), Kombination digitaler und anderer Technologien);
 - ii) die Förderung von Forschungsinfrastrukturen im Rahmen der Säule „Wissenschaftsexzellenz“;
 - iii) die Integration der digitalen Technik in allen „Globalen Herausforderungen“ (Gesundheit, Sicherheit, Energie und Mobilität, Klima usw.) und
 - iv) Unterstützung für bahnbrechende Innovationen durch Scale-up-Unternehmen (von denen viele digitale und andere Technologien kombinieren werden) im Rahmen der Säule „Innovatives Europa“.
- c) Die Initiative konzentriert sich ausschließlich auf den Aufbau umfänglicher Kapazitäten im Bereich der Halbleiter- und Quantentechnik in ganz Europa. Es wird investiert in
- i) die Förderung von Innovation durch die Unterstützung zweier eng miteinander verknüpfter technischer Kapazitäten, die die Entwicklung neuartiger Systemkonzepte und deren Erprobung und Validierung in Pilotanlagen ermöglichen,
 - ii) die gezielte Unterstützung für den Aufbau von Ausbildungskapazitäten und die Verbesserung angewandter fortgeschrittener digitaler Kompetenzen und Qualifikationen, um die Entwicklung und den Einsatz von Halbleitern durch technische Entwicklung und die Endnutzerindustrie zu unterstützen, und
 - iii) ein Netz nationaler Kompetenzzentren, die den Zugang zu und die Bereitstellung von Fachwissen und Innovationsdiensten für Endnutzergemeinschaften und -industrien erleichtern, um neue Produkte und Anwendungen zu entwickeln und Marktversagen zu beheben.

- d) Die technischen Kapazitäten der Initiative werden der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft zur Verfügung gestellt, auch für Maßnahmen, die im Rahmen von „Horizont Europa“ gefördert werden.
 - e) In dem Maße wie die im Rahmen von Horizont Europa entwickelten neuartigen digitalen Technologien im Halbleiterbereich zur Reife kommen, werden diese Technologien soweit möglich schrittweise mithilfe des Programms aufgegriffen und eingeführt.
 - f) Programme zur Entwicklung von Curricula der Fertigkeiten und Kompetenzen im Rahmen von Horizont Europa, darunter jene, die von den Kolokationszentren der Wissens- und Innovationsgemeinschaften des EIT durchgeführt werden, werden durch Maßnahmen zum Aufbau angewandter fortgeschrittener digitaler Kompetenzen im Bereich der Halbleiter- und Quantentechnik ergänzt, die im Rahmen der Initiative gefördert werden.
 - g) Es werden starke Koordinierungsmechanismen für die Planung und Durchführung eingerichtet, sodass alle Verfahren sowohl für das Programm Horizont Europa und die Initiative so weit wie möglich aufeinander abgestimmt werden können. Alle betroffenen Kommissionsdienststellen werden in ihre Governance-Strukturen einbezogen sein.
3. Synergien mit Unionsprogrammen mit geteilter Mittelverwaltung, einschließlich **des EFRE, des ESF+, des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds**, gewährleisten die Entwicklung und Stärkung regionaler und lokaler Innovationsökosysteme, den industriellen Wandel sowie den digitalen Wandel der Gesellschaft und der öffentlichen Verwaltungen. Das umfasst die Unterstützung des digitalen Wandels der Industrie und der Verbreitung von Ergebnissen sowie der Einführung neuartiger Technologien und innovativer Lösungen. Die Initiative wird die transnationale Vernetzung und Kartierung von Kapazitäten ergänzen und fördern und sie KMU und Nutzerbranchen in allen Regionen der Union zugänglich machen.

4. Synergien mit der **Fazilität „Connecting Europe“** müssen Folgendes sicherstellen:
- a) Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf dem großflächigen Aufbau digitaler Kapazitäten und Infrastrukturen im Halbleiterbereich. Dabei zielt es auf eine breite europaweite Einführung und Verbreitung entscheidender bestehender oder erprobter innovativer digitaler Lösungen innerhalb eines Unionsrahmens in Bereichen von öffentlichem Interesse oder von Marktversagen ab. Die Initiative soll mit den Mitgliedstaaten, hauptsächlich durch koordinierte und strategische Investitionen in den Aufbau digitaler Kapazitäten für die Halbleitertechnik, die europaweit gemeinsam genutzt werden sollen, und in unionsweite Maßnahmen umgesetzt werden. Dies ist besonders wichtig für die Elektrifizierung und autonomes Fahren und sollte die Entwicklung wettbewerbsfähigerer industrieller Endverbraucher, insbesondere in den Bereichen Mobilität und Verkehr, begünstigen und erleichtern.
 - b) Die mithilfe der Initiative geschaffenen Kapazitäten und Infrastrukturen sind für die Erprobung neuer Technologien und Lösungen zur Verfügung zu stellen, die im Bereich Mobilität und Verkehr genutzt werden können. Die Fazilität „Connecting Europe“ unterstützt die Einführung und den Einsatz innovativer neuer Technologien und Lösungen im Bereich Mobilität und Verkehr sowie in anderen Bereichen.
 - c) Es sind Koordinierungsmechanismen zu schaffen, insbesondere durch geeignete Governance-Strukturen.
5. Synergien mit dem **Programm „InvestEU“** müssen Folgendes sicherstellen:
- a) Im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/523 erfolgt eine Förderung durch marktgestützte Finanzierung, darunter auch zur Verfolgung der politischen Ziele der Initiative. Eine solche marktgestützte Finanzierung könnte mit der Gewährung von Finanzhilfen kombiniert werden.
 - b) Eine Mischfinanzierungsfazilität im Rahmen des Fonds „InvestEU“ wird durch Mittel aus dem Programm „Horizont Europa“ oder dem Programm „Digitales Europa“ in Form von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von Mischfinanzierungsmaßnahmen unterstützt.

6. Synergien mit **Erasmus+** müssen Folgendes sicherstellen:
- a) Die Initiative fördert gemeinsam mit einschlägigen Wirtschaftszweigen die Entwicklung und den Erwerb fortgeschrittener digitaler Kompetenzen, die für die Entwicklung und Einführung modernster Halbleitertechnik in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Industriezweigen notwendig sind.
 - b) Der den fortgeschrittenen Kompetenzen gewidmete Teil von Erasmus+ ergänzt die Interventionen im Rahmen der Initiative, indem der Erwerb von Kompetenzen in allen Bereichen und auf allen Ebenen durch Mobilitätserfahrungen bereichert wird.
7. Synergien mit anderen Programmen und Initiativen der Union zu Kompetenzen und Qualifikationen müssen sichergestellt werden.
-